

国泰君安证券股份有限公司

关于

武汉新芯集成电路股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

目 录

| | |
|----------------------------------------------------|----|
| 目 录..... | 1 |
| 一、发行人基本情况 | 3 |
| 二、发行人本次发行情况 | 14 |
| 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员 | 16 |
| 四、保荐人与发行人之间的关联关系 | 17 |
| 五、保荐人承诺事项 | 18 |
| 六、保荐人对本次发行上市的推荐结论 | 19 |
| 七、本次证券发行履行的决策程序 | 19 |
| 八、保荐人关于发行人符合科创板定位及国家产业政策的说明 | 19 |
| 九、保荐人关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的逐项说明 | 24 |
| 十、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 | 29 |

国泰君安证券股份有限公司

关于武汉新芯集成电路股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书

上海证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）接受武汉新芯集成电路股份有限公司（以下简称“发行人”、“新芯股份”、“公司”）的委托，担任新芯股份首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第2号——上市保荐书内容与格式》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的本上市保荐书真实、准确和完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《武汉新芯集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。

一、发行人基本情况

（一）基本信息

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| 中文名称 | 武汉新芯集成电路股份有限公司 |
| 英文名称 | Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. |
| 注册资本 | 847,900.6412 万元人民币 |
| 法定代表人 | 孙鹏 |
| 有限公司成立日期 | 2006 年 4 月 21 日 |
| 股份公司成立日期 | 2024 年 3 月 29 日 |
| 住所 | 武汉市东湖新技术开发区高新四路 18 号 |
| 邮政编码 | 430205 |
| 联系电话 | 027-87708900 |
| 传真 | 027-81738000 |
| 互联网网址 | www.xmcwh.com |
| 电子信箱 | ir@xmcwh.com |
| 信息披露和投资者关系负责部门 | 董事会办公室 |
| 信息披露和投资者关系负责人及联系方式 | 汤海燕，027-87708900 |

（二）主营业务

公司是国内领先的半导体特色工艺晶圆代工企业，聚焦于特色存储、数模混合和三维集成等业务领域，可提供基于多种技术节点、不同工艺平台的各类半导体产品晶圆代工。

在特色存储领域，公司是中国大陆规模最大的 NOR Flash 制造厂商，拥有业界领先的代码型闪存技术，制造工艺涵盖浮栅（Floating Gate，又称 ETOX）型与电荷俘获（Charge Trap，又称 SONOS）型两种主流结构。公司在浮栅工艺上制程节点涵盖 65nm 到 50nm，其中 50nm 技术平台具有业内领先的存储密度。

在数模混合领域，公司具备 CMOS 图像传感器制造全流程工艺，拥有多年稳定量产的 BSI 工艺和堆栈式工艺，技术平台布局完整、技术实力领先；公司 12 英寸 RF-SOI 工艺平台已经实现 55nm 产品量产，射频器件性能国内领先，广

泛应用于智能手机等无线通讯领域。

在三维集成领域，公司拥有国际领先的硅通孔、混合键合等核心技术，公司双晶圆堆叠、多晶圆堆叠、芯片-晶圆异构集成以及硅转接板技术应用不断拓展。

截至 2024 年 3 月末，公司共拥有两座 12 英寸晶圆厂。报告期内，公司先后承担十余项国家级、省市级重大科研项目，技术研发成果曾荣获“中国专利优秀奖”、“湖北科技进步一等奖”、“湖北专利奖金奖”等奖项及荣誉。公司入选第一批国家鼓励的集成电路企业名单，连续多年位列中国半导体行业协会“中国半导体制造十大企业”。

报告期内，公司以特色存储业务为支撑、以三维集成技术为牵引，各项业务平台深化协同，持续进行技术迭代。目前，公司多项技术及产品已广泛应用于汽车电子、工业控制、消费电子、计算机等下游领域，与各细分行业头部厂商形成了稳定、良好的合作关系。未来，公司致力于成为三维时代半导体先进制造引领者，助力客户提升核心竞争力，繁荣中国半导体高端应用。

（三）核心技术与研发水平

1、公司主要核心技术概况

截至本上市保荐书签署日，公司的主要核心技术平台情况如下：

| 序号 | 类别 | 核心技术平台 | 技术工艺特征及先进性表征 | 技术来源 | 先进性 |
|----|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1 | 特色存储 | 独立式非易失性代码型闪存（NOR Flash） | <p>①拥有业内领先的代码型闪存技术，支持 1.8~3.3V 工作电压，自主研发的 50nm 技术平台具有业界领先的存储密度。公司“代码型闪存芯片成套核心技术研发及其产业化”曾获 2020 湖北科技进步一等奖。</p> <p>②公司全平台 12 英寸 NOR Flash 晶圆累计出货超百万片。公司自有品牌 NOR Flash 产品涵盖 1.2V 到 3.3V 输入电压，其擦写速度与耐受性、数据保持等可靠性与特性指标业内领先。</p> <p>③所提供晶圆代工及自有品牌的 NOR Flash 产品广泛应用于计算机、消费电子、汽车电子、工业控制、物联网设备等各项领域。</p> | 自主研发 | 国际领先 |
| 2 | 数模混合 | 射频绝缘体上硅（RF-SOI） | <p>①自主开发的 55nm RF-SOI 技术，可提供射频开关、低噪声放大器、天线调谐器、功率放大器等多样化的器件集成，具有性能优值好、谐波低、截止频率高、噪声系数低、功率高等性能优势。</p> <p>②射频器件关键性能如低噪声放大器截止频率、射频开关性能优值(FoM, Figure of Merit)、天线调谐器</p> | 自主研发 | 国内领先 |

| 序号 | 类别 | 核心技术平台 | 技术工艺特征及先进性表征 | 技术来源 | 先进性 |
|----|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | 工作电压等达到国内领先水平。 ③已实现 55nm RF-SOI 产品量产。 | | |
| | | CMOS 图像传感器 (CIS) | ①具备 55nmCIS 全流程制造工艺, 像素尺寸覆盖 0.7um 及以上, 拥有成熟量产的 BSI、堆栈式后道工艺, 信噪比、动态范围、暗电流等工艺相关的关键性能指标达到国际先进水平。 ②CIS 平台技术品类丰富, 覆盖消费、车载、医疗等不同应用领域。 ③拥有成熟的 CIS 技术配套设备及产线管理能力, 稳定量产超过 10 年。 ④中国大陆首家量产 BSI 技术的晶圆代工厂, 工艺能力及可靠性与全球领先水平相当。 | 自主研发 | 国际先进 |
| 3 | 三维集成 | 双晶圆堆叠 | ①基于大规模生产验证的熔融键合工艺堆叠晶圆, 通过铜或钨金属填充硅通孔实现垂直互联, 提供多种连接密度以支持多样化应用需求。自主知识产权的工艺方案, 关键技术荣获中国专利优秀奖。 ②提供业界领先的混合键合密度、精度、强度和可靠性, 有效增加传输带宽, 减少延时及功耗, 提高芯片性能。 ③支持不同技术节点、不同制程种类及来源的晶圆预处理, 及成熟的背面减薄和背面引线工艺方案, 支持多样化晶圆减薄厚度需求。 ④该技术相较业界同行具有混合键合密度高的显著优点。 | 自主研发 | 国际领先 |
| | | 多晶圆堆叠 | ①拥有国际领先的多片晶圆堆叠技术, 基于硅通孔、混合键合、晶圆减薄、重布线层等工艺组合, 支持多片晶圆垂直互联, 可显著提高单位面积内的存储或功能密度。 ②拥有自主知识产权的多片堆叠应力管理、晶边处理等成套工艺及模块化工艺流程, 提供行业领先的良率及生产周期。 ③该技术相较业界微凸块封装形式具有功耗更低、散热性能更好的特点。 | 自主研发 | 国际领先 |
| | | 芯片-晶圆异构集成 | ①拥有自主知识产权的芯片对晶圆垂直互联工艺, 可实现不同尺寸、不同材料、不同功能的芯片-晶圆间无凸点直接键合异构集成。 ②拥有中国大陆首条自主可控的三维异构集成工艺产线, 支持需求灵活、创新架构设计的高集成度复杂芯片的生产制造。 | 自主研发 | 国际领先 |
| | | 2.5D (硅转接板 Interposer) | 拥有国际先进的 2.5D (硅转接板) 技术, 包含多光罩超大尺寸拼接、超高密度深沟槽电容及深硅穿孔技术, 为集成系统提供具有亚微米级精度铜互连线的封装基板, 显著减小系统延迟、插损及功耗等。 | 自主研发 | 国际先进 |

2、核心技术在主营业务及产品或服务中的应用和贡献情况

报告期内, 发行人核心技术广泛应用于发行人各类技术平台中。发行人应用核心技术产生的收入及其占营业收入比重情况如下:

单位：万元

| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 核心技术产生的收入 | 91,226.43 | 379,579.62 | 333,431.66 | 292,991.61 |
| 营业收入 | 91,252.09 | 381,453.85 | 350,725.34 | 313,842.37 |
| 占营业收入的比重 | 99.97% | 99.51% | 95.07% | 93.36% |

3、核心技术的保护措施

（1）知识产权保护

公司为保护无形资产完整，明确科研成果归属，制定了知识产权管理的相关制度，建立了涵盖专利申请、商标注册、商业秘密保护等多层次的知识产权管理体系。例如，针对职务发明创造，公司明确规定其专利申请权和专利权归属于公司，同时应就获得授权的专利对职务发明创造的发明人给予奖金；此外，对于不适宜进行公开披露的重要技术发明作为商业秘密进行保护。

（2）保密与竞业禁止制度

为确保职务作品归属，避免员工流动导致的技术秘密外泄，防范与员工之间的知识产权争议，公司整体制订了关于员工竞业禁止限制方面的规范制度，同时与主要技术人员在劳动合同及相关附件中就保密义务及竞业禁止义务进行了详细约定。例如，要求相关人员在任职期间及离职后对公司机密信息应严格保密，以及明确其竞业限制/禁止的范围、期限以及违约责任等。

（3）员工跟投计划

为打造稳定、高效、专业的研发团队，促进研发人员的科研创新热情，锁定高级管理人员及核心员工，发行人亦于报告期内制定了员工跟投计划，通过员工持股的方式实现对主要技术人员的有效激励，从而进一步稳固公司研发团队、保护公司核心技术。

（四）科研实力和成果情况

1、公司参与的重大科研项目情况

公司作为国内领先的半导体特色工艺晶圆代工企业，在相关业务领域具有强大科研实力和工艺创新能力，长期承担及参与各类重大科研项目。报告期内，公司承担、参与了十余项国家级和省市级重大科研项目。

2、专利情况

截至 2024 年 3 月 31 日，发行人及其子公司已获授权的发明专利共计 692 项（其中包含 71 项境外专利、10 项共有专利）、实用新型专利 237 项。

3、公司及其产品获得重要奖项的情况

报告期内，公司获得的主要荣誉奖项如下：

| 序号 | 荣誉名称 | 颁发单位 | 获得时间 |
|----|-------------------------|-----------------|--------|
| 1 | 2022 年度湖北省高新技术企业百强 | 湖北省科技厅 | 2023 年 |
| 2 | 武汉市科技领军企业 | 武汉市科学技术局 | 2023 年 |
| 3 | 第二十三届中国专利优秀奖 | 国家知识产权局 | 2022 年 |
| 4 | 2022 年度湖北省知识产权优势企业（专利类） | 湖北省知识产权局 | 2022 年 |
| 5 | 2021 年度湖北省高新技术企业百强 | 湖北省科技厅 | 2022 年 |
| 6 | 2020 年中国半导体制造十大企业 | 中国半导体行业协会 | 2021 年 |
| 7 | 湖北省专利奖金奖 | 湖北省人民政府 | 2021 年 |
| 8 | 2021 年中国 IC 设计成就奖 | AspenCore | 2021 年 |
| 9 | 第六届全国专业技术人才先进集体 | 中组部、中宣部、人社部、科技部 | 2021 年 |
| 10 | 湖北省科技进步一等奖 | 湖北省人民政府 | 2021 年 |

（五）主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

| 项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 流动资产合计 | 8,012,179,812.59 | 4,509,826,947.32 | 5,137,881,477.50 | 3,869,274,464.15 |
| 非流动资产合计 | 10,776,186,462.55 | 10,523,694,846.39 | 6,386,510,495.94 | 4,948,121,379.46 |
| 资产总计 | 18,788,366,275.14 | 15,033,521,793.71 | 11,524,391,973.44 | 8,817,395,843.61 |
| 流动负债合计 | 2,633,342,157.04 | 5,364,507,370.53 | 2,832,587,602.84 | 1,781,080,327.11 |
| 非流动负债合计 | 3,792,012,186.18 | 2,476,362,586.24 | 1,513,508,654.01 | 1,379,244,683.79 |
| 负债合计 | 6,425,354,343.22 | 7,840,869,956.77 | 4,346,096,256.85 | 3,160,325,010.90 |
| 归属于母公司股东/所有者权益合计 | 12,363,011,931.92 | 7,192,651,836.94 | 7,178,295,716.59 | 5,657,070,832.71 |

| 项目 | 2024年 3月31日 | 2023年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2021年 12月31日 |
|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 股东/所有者权益合计 | 12,363,011,931.92 | 7,192,651,836.94 | 7,178,295,716.59 | 5,657,070,832.71 |

2、合并利润表主要数据

单位：元

| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 912,520,938.29 | 3,814,538,543.11 | 3,507,253,369.18 | 3,138,423,731.70 |
| 营业利润 | 5,077,465.18 | 427,433,228.23 | 780,122,034.46 | 673,738,189.59 |
| 净利润 | 14,866,383.55 | 393,755,969.26 | 716,602,607.25 | 638,730,833.73 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,866,383.55 | 393,755,969.26 | 716,602,607.25 | 638,756,851.63 |

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 276,093,126.38 | 1,709,894,135.31 | 2,275,120,647.49 | 1,356,127,632.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,442,496,981.24 | -3,353,877,477.76 | -1,504,124,225.04 | -1,394,588,659.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,835,134,203.08 | 1,139,725,287.19 | 58,504,477.01 | 654,688,582.01 |
| 期/年末现金及现金等价物余额 | 5,319,643,763.74 | 2,647,710,736.37 | 3,118,645,456.99 | 2,131,285,783.06 |

4、主要财务指标

| 财务指标 | 2024年1-3月 /2024年3月31日 | 2023年度/2023 年12月31日 | 2022年度/2022 年12月31日 | 2021年度/2021 年12月31日 |
|---------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 流动比率（倍） | 3.04 | 0.84 | 1.81 | 2.17 |
| 速动比率（倍） | 2.56 | 0.61 | 1.34 | 1.76 |
| 资产负债率（母公司） | 34.18% | 52.13% | 37.66% | 35.78% |
| 资产负债率（合并） | 34.20% | 52.16% | 37.71% | 35.84% |
| 应收账款周转率（次/年） | 9.32 | 7.73 | 6.03 | 5.49 |
| 存货周转率（次/年） | 2.42 | 2.26 | 2.13 | 3.37 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 31,815.96 | 139,954.92 | 152,265.58 | 135,465.52 |
| 利息保障倍数（倍） | 10.18 | 32.00 | 71.28 | 68.06 |

| 财务指标 | 2024 年 1-3 月 /2024 年 3 月 31 日 | 2023 年度/2023 年 12 月 31 日 | 2022 年度/2022 年 12 月 31 日 | 2021 年度/2021 年 12 月 31 日 |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 归属于母公司所有者的净利润（万元） | 1,486.64 | 39,375.60 | 71,660.26 | 63,875.69 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） | 1,381.49 | 37,259.71 | 66,873.33 | 54,014.16 |
| 研发投入占营业收入的比例 | 7.52% | 6.86% | 6.65% | 6.16% |
| 每股经营活动产生的现金流量（元/股） | 0.03 | 0.30 | 0.39 | 0.24 |
| 每股净现金流量（元/股） | 0.32 | -0.08 | 0.17 | 0.11 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产（元/股） | 1.46 | 1.24 | 1.24 | 1.02 |

注：上述部分主要财务指标的计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 3、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值，2024 年 1-3 月数据已折算全年，下同
- 4、存货周转率=营业成本/存货平均账面价值，2024 年 1-3 月数据已折算全年，下同
- 5、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出（财务费用项下）+折旧与摊销
- 6、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出（财务费用项下）
- 7、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入
- 8、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- 9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
- 10、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末股本总额

（六）主要风险

1、与行业相关的风险

（1）宏观经济波动和行业周期性的风险

半导体行业发展受宏观经济影响显著，全球经济走势、行业景气度以及产能周期等因素都对半导体行业产生重要影响，导致行业存在一定周期特征。报告期内，半导体行业出现了整体波动的情况。2020 年以来，随着全球信息化和数字化的加速发展、下游消费类需求的快速增长，半导体产业呈现出明显的高投资趋势，全球制造产能快速扩张，致使市场在 2022 年出现供过于求的情况，消费电子市场总体需求走低，半导体行业景气度下行。2023 年全球半导体市场规模缩水至 5591.36 亿美元，较 2022 年下降 8.92%。截至目前，全球半导体行业处于从

低位逐步回升的时期。

在晶圆代工制造环节，下游市场需求的波动和低迷会导致晶圆代工的需求下降，从而影响行业整体价格和利润率水平。因此，如若发行人未能及时应对上述宏观经济环境变化及行业周期性的整体波动，可能会对公司经营业绩产生潜在不利影响。

（2）国际贸易摩擦的风险

目前，半导体晶圆代工行业制造与供应体系整体仍有赖于全球化分工合作。报告期内，公司生产运营所需的主要机器设备及原材料部分采购自境外供应商；此外，公司销售区域覆盖中国大陆及中国香港、亚洲其他地区及欧美等境内外区域。如未来国际间贸易摩擦加剧，相关国家可能调整出口管制政策，导致公司面临设备、原材料供应受到一定限制或进口成本增加，境外采购及销售可能因此受到影响，对公司业务及经营造成不利影响。

（3）工艺平台技术迭代无法满足市场需求的风险

半导体晶圆代工行业具有工艺技术迭代快、资金投入大、研发周期长等特点，伴随相关工艺技术的革新及竞争水平的提高，预计未来市场对公司工艺技术迭代更新的速度和成效将提出更高的要求，如若公司在相关领域的进展未能取得良好效果、未能适配市场需求，则可能导致公司难以保持市场竞争地位，进而对经营及财务状况产生不利影响。

（4）产业政策变化的风险

半导体产业作为我国战略支柱产业，得益于国家政策支持，近年来实现了快速有力发展。相关产业政策覆盖税收、人才培养和技术创新等各方面，有效提升了行业内企业市场竞争力和可持续发展潜力。然而，产业政策面临变化的不确定性，如未来国家相关产业政策出现不利变化，将可能一定程度上对公司业务发展、人才引进和生产经营等造成不利影响。

2、与发行人相关的风险

（1）固定资产投资风险

晶圆代工行业属于典型的资本密集型行业，固定资产投资的需求较高。截至

2024年3月31日，公司固定资产的账面价值为816,571.45万元，占公司总资产的比例为43.46%；公司在建工程的账面价值为211,447.96万元，占公司总资产的比例为11.25%。公司持续的产能扩充对后续资金投入提出了较高要求，公司的资金筹措能力面临较大的考验。

同时，半导体行业晶圆制造环节产能扩充呈现周期性变化特征，下游需求变化速度较快而上游产能增减通常需要更长时间。因此，固定资产投资建设周期内可能面临下游市场需求的快速变化，供应端产能增长与市场需求存在错配风险。若公司新增固定资产投资无法适应市场需求或在相关技术领域的收入规模增长有限，则可能无法消化大额固定资产投资带来的新增折旧，导致公司面临盈利能力下降的风险。

（2）经营业绩及毛利率波动风险

报告期各期，公司营业收入分别为313,842.37万元、350,725.34万元、381,453.85万元和91,252.09万元，归属于母公司股东的净利润分别为63,875.69万元、71,660.26万元、39,375.60万元和1,486.64万元，公司综合毛利率分别为32.11%、36.51%、22.69%和16.64%，报告期内，公司营业收入呈现增长趋势，受市场需求、产品结构调整等因素影响，公司毛利率水平存在一定波动。

如未来受到行业周期、市场波动、下游市场需求变化、原材料成本上升、固定资产折旧增加，或者公司技术平台推广不及预期、产能利用率下降等影响，且公司未能采取有效措施及时应对上述市场变化，将面临经营业绩及毛利率波动的风险，极端情况下有可能导致公司出现发行上市当年营业利润同比下滑50%以上甚至亏损的风险。

（3）无实际控制人的风险

截至本上市保荐书签署日，长控集团直接持有发行人68.19%的股份，系发行人的控股股东。长控集团的股权结构较为分散，结合长控集团的历史沿革、公司章程、董事高管提名及任命情况、股东会和董事会对重大事项的表决结果、内部治理结构及日常经营管理决策，长控集团不存在实际控制人，因此发行人不存在实际控制人。

公司控股股东较为分散的股权结构可能影响其对于下属子公司的决策效率，

使得发行人存在错失发展机遇的风险。此外，公司未来若控股股东发生股权变动可能间接导致发行人控制权发生变动，进而给公司经营和业务稳定带来潜在的风险。

（4）存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 73,253.49 万元、135,597.33 万元、124,796.54 万元及 126,577.50 万元，占资产总额的比例分别为 8.31%、11.77%、8.30%及 6.74%。公司通常根据客户订单和销售预测进行生产备货，但如果下游客户因其生产销售计划原因调整采购需求，暂缓或取消订单，或者受行业市场竞争加剧的影响，公司的产品市场价格下降，公司存货将面临减值的风险，从而对公司经营业绩造成一定的不利影响。

（5）供应商集中度较高的风险

报告期内，公司向前五大原材料供应商合计采购额分别为 32,348.03 万元、49,477.58 万元、29,364.57 万元和 9,599.93 万元，占当期采购总额的比例分别为 41.46%、42.62%、34.46%和 35.51%，供应商集中度相对较高。尽管目前发行人所需采购的原材料供应相对充足，但若未来由于贸易摩擦或其他不可抗力因素导致原材料供应商延迟交货、限制供应或提高价格，可能对发行人持续生产经营能力造成不利影响。

（6）知识产权的风险

发行人所处的晶圆代工行业属于典型的技术密集型行业，包括生产工艺、专利、集成电路布图设计、商业秘密等在内的知识产权是公司在行业内保持自身竞争力的关键。随着公司业务发展和市场开拓，公司的知识产权在未来可能遭受不同形式的侵犯，中国以及其他国家或地区的知识产权法律提供的保护或这些法律的执行未必有效，公司实施或保护知识产权的能力可能受到限制，且成本可能较高。因此，如果公司的知识产权不能得到充分保护，公司未来业务发展和经营业绩可能会受到不利影响。同时，其他竞争者可能指控公司侵犯其知识产权，从而对公司业务发展和经营业绩产生不利影响。

（7）研发人员不足或流失的风险

半导体行业属于技术密集型、人才密集型产业，特别是公司所处的晶圆代工

领域，生产工艺流程复杂，技术研发涉及多学科交叉，对研发人员的专业程度、经验水平、综合素质要求较高，对高水平研发人员的培养周期长、难度大。因此公司存在研发人员不足或流失的风险，如未能保持研发团队的稳定性并持续扩充、吸引人才，则可能影响技术更新迭代进程，使公司在行业竞争格局中处于不利境地，对生产经营造成不利影响。

（8）内部控制风险

公司结合自身经营管理特点建立了较为完善的法人治理结构和风险控制体系。但报告期内，公司生产经营规模不断扩大，资产规模、员工人数持续增长，随着募集资金投资项目的实施，公司资产规模和人员规模也将进一步扩大，对公司组织管理制度、经营管理能力、法人治理水平和风险控制体系均提出了更高的要求。若公司内部管理制度不能有效贯彻落实并持续完善，将面临较大的管理失效风险。

（9）安全生产的风险

公司生产涉及部分机械设备操作且所需的部分原材料存在一定危险性，对于操作人员的技术及操作工艺流程要求较高。若公司在安全生产管理制度上出现漏洞、管理不规范或生产人员在生产过程中未严格按照安全生产制度进行生产作业等，则公司存在发生安全生产事故，导致员工伤亡、财产损失、产线停工及受到相关部门行政处罚的风险，将对公司的生产经营产生不利影响。

（10）汇率波动风险

公司交易存在人民币、美元、日元等多种币种结算。报告期内，公司汇兑损益分别为-1,372.82万元、2,612.86万元、-3,208.60万元和-1,011.38万元。公司在经营过程中重视外币资产和外币负债在规模上的匹配，合理控制外汇风险敞口。但未来如果境内外经济环境、政治形势、货币政策、融资环境等因素发生变化，使得本外币汇率大幅波动，公司仍将面临汇兑损失的风险。

公司记账本位币为美元，因公司披露的财务数据以人民币列报，需对相关报表进行汇率折算。如果未来人民币兑美元汇率发生重大变化，将可能对折算后的人民币财务数据带来一定偏差，一定程度上放大比较期间财务数据的变化幅度，并影响投资者对财务报表的使用。

（11）环境保护的风险

发行人在生产经营中会产生废水、废气和固体废物，需遵守环境保护方面的相关法律法规。发行人在日常生产经营过程中制定并执行了严格的环保制度，但未来如果公司由于环保设施运行故障等原因发生环境污染事件，可能将受到相关部门的行政处罚，并对公司的生产经营产生不利影响。同时，如果国家或地方出台更为严格的环保要求，公司需投入相应资金对现有环保设施进行升级改造。

（12）募投项目短期影响经营业绩或未来无法达到预期收益的风险

公司本次募集资金投资项目实施后，公司固定资产规模预计将大幅增加。一方面，由于募投项目的投资回收期较长，在短期内其新增折旧和摊销或将对公司经营业绩产生一定不利影响；另一方面，如果市场环境发生重大不利变化，公司募集资金投资项目产生的收入及利润未能达到预计水平，公司亦将面临无法达到预期收益的风险。

3、其他风险

（1）发行失败的风险

本次发行的结果将受到证券市场整体情况、公司经营业绩、投资者对公司价值的判断等多种因素的影响。公司股票发行价格确定后，若发行人网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，应当根据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的相关规定中止发行。中止发行后，在中国证监会予以注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，公司需向上交所备案，方可重新启动发行。若公司未在中国证监会予以注册决定的有效期内完成发行，公司将面临发行失败的风险。

二、发行人本次发行情况

| （一）本次发行的基本情况 | | | |
|--------------|---------------------|-----------|---------|
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） | | |
| 每股面值 | 1.00元 | | |
| 发行股数 | 不超过 2,826,335,470 股 | 占发行后总股本比例 | 不超过 25% |
| 其中：发行新股数量 | 不超过 2,826,335,470 股 | 占发行后总股本比例 | 不超过 25% |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 股东公开发售股份数量 | - | 占发行后总股本比例 | - |
| 发行后总股本 | 不超过 11,305,341,882 股（不考虑超额配售选择权） | | |
| 每股发行价格 | 【】元 | | |
| 发行市盈率 | 【】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算） | | |
| 发行前每股净资产 | 【】元 | 发行前每股收益 | 【】元 |
| 发行后每股净资产 | 【】元 | 发行后每股收益 | 【】元 |
| 发行市净率 | 【】（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） | | |
| 发行方式 | 采用网下向配售对象询价发行和网上资金申购定价发行相结合的方式或采用证券监管部门认可的其他发行方式 | | |
| 发行对象 | 符合规定资格的询价对象和在上交所开立账户并已开通科创板市场交易账户的合格投资者或证券监管部门认可的其他发行对象 | | |
| 承销方式 | 余额包销 | | |
| 募集资金总额 | 【】万元 | | |
| 募集资金净额 | 【】万元 | | |
| 募集资金投资项目 | 12 英寸集成电路制造生产线三期项目 | | |
| | 特色技术迭代及研发配套项目 | | |
| 发行费用概算 | 本次发行费用总额为【】万元，包括：承销及保荐费【】万元、律师费用【】万元、审计及验资费用【】万元、信息披露费用【】万元、发行手续费用【】万元 | | |
| 高级管理人员、员工拟参与战略配售情况 | 若公司决定实施高管及员工战略配售，则在本次公开发行股票注册后、发行前，履行内部程序审议该事项的具体方案，并依法进行披露 | | |
| 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 | 保荐人将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐人及相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件 | | |
| 拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则 | 无 | | |
| （二）本次发行上市的重要日期 | | | |
| 刊登发行公告日期 | 【】年【】月【】日 | | |
| 开始询价推介日期 | 【】年【】月【】日 | | |
| 刊登定价公告日期 | 【】年【】月【】日 | | |
| 申购日期和缴款日期 | 【】年【】月【】日 | | |
| 股票上市日期 | 【】年【】月【】日 | | |

三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员

（一）保荐人和保荐代表人、项目协办人的联系方式

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

保荐代表人：李冬、寻国良

项目协办人：林韬

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

电 话：021-3867 6666

传 真：021-3867 0666

（二）具体负责本次推荐的保荐代表人

本保荐人指定李冬、寻国良作为新芯股份首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人。

李冬先生：本项目保荐代表人，国泰君安投资银行部执行董事，中国注册会计师协会非执业会员，硕士研究生。曾负责或参与晶晨股份、源杰科技、华虹公司、宁波四维、新宏泽等 IPO 项目，中远海能非公开发行、利尔化学可转债、武汉控股发行股份购买资产等项目。李冬先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

寻国良先生：本项目保荐代表人，国泰君安投资银行部董事总经理、半导体与集成电路行业部行政负责人，中国注册会计师协会非执业会员，硕士研究生。曾负责或参与华虹公司、晶晨股份、中科飞测、赛微微电、景嘉微、华海清科、源杰科技、寒武纪、圣泉集团等 IPO 项目，北京君正、景嘉微、长江传媒、包钢股份等非公开发行股票项目，兆易创新发行股份购买资产、北京君正发行股份购买资产等重组项目。寻国良先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

（三）项目协办人及其他项目组成员

林韬先生：本项目协办人，国泰君安投资银行部业务董事，硕士研究生，曾负责或参与寒武纪、华虹公司、圣泉集团、诚瑞光学等 IPO 项目，景嘉微非公开

发行股票项目，利尔化学可转债项目，兆易创新发行股份购买资产项目等。林韬先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

其他项目组成员包括：陈健、卢瀚、陈家兴、林烽炜、朱大春、万芷萱、陶然、田方军、任飞、李嘉琪、应佳、王依、郝昕哲、王立炜、贺南涛、谢欣灵、李淳、张蕾、卢含笑、张旭、罗巧雯、刘阳。

四、保荐人与发行人之间的关联关系

1、截至本上市保荐书出具日，本次发行的保荐人（主承销商）国泰君安安全全资子公司国泰君安证裕投资有限公司、华源证券全资子公司华证资本投资（北京）有限公司拟参与本次发行战略配售。

截至本上市保荐书出具日，发行人持股 0.37% 的股东国鑫创投与本次发行的保荐机构国泰君安同受上海国际集团有限公司控制。武汉金控为华源证券间接持股 50% 的控股股东，通过国芯基金持有发行人控股股东长控集团 5.98% 的股权，通过武汉芯盛持有发行人 3.52% 的股份；湖北科投为华源证券间接持股 16.31% 的股东，间接持有发行人 5% 以上股份；发行人董事程驰光为华源证券董事。

除上述情况外，不存在保荐人或其控股股东、重要关联方持有或者通过参与本次战略配售持有发行人或其控股股东、重要关联方股份的情况；

2、截至本上市保荐书出具日，不存在发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐人或其控股股东、重要关联方股份的情况；

3、截至本上市保荐书出具日，不存在保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员持有发行人或其控股股东及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东及重要关联方任职的情况；

4、截至本上市保荐书出具日，不存在保荐人的控股股东、重要关联方与发行人控股股东、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

5、截至本上市保荐书出具日，不存在保荐人与发行人之间的其他关联关系。

五、保荐人承诺事项

（一）保荐人对本次上市保荐的一般承诺

保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所的相关规定，对发行人及其控股股东进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。根据发行人的委托，保荐人组织编制了本次公开发行股票并上市申请文件，同意推荐发行人本次证券发行上市，并据此出具本上市保荐书。

（二）保荐人对本次上市保荐的逐项承诺

保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会、上交所等有关规定对发行人进行了充分的尽职调查和辅导，保荐人有充分理由确信发行人至少符合下列要求：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证本上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9、中国证监会规定的其他事项。

六、保荐人对本次发行上市的推荐结论

在充分尽职调查、审慎核查的基础上，本保荐人认为，新芯股份首次公开发行股票并在科创板上市符合《公司法》《证券法》《注册办法》《保荐业务管理办法》等法律、法规和规范性文件中有关首次公开发行股票并在科创板上市的条件。同意推荐新芯股份本次证券发行上市。

七、本次证券发行履行的决策程序

经核查，发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上交所有关规定的决策程序，具体如下：

2024年8月25日，发行人召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。

2024年9月20日，发行人召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了上述与本次发行上市相关的议案。

2024年9月23日，发行人召开第一届董事会第八次会议，审议通过了有关募投项目金额调整的议案。

八、保荐人关于发行人符合科创板定位及国家产业政策的说明

（一）发行人符合科创板定位的理由和依据

1、发行人符合科创板支持方向

（1）公司符合国家科技创新战略情况

公司是国内领先的半导体特色工艺晶圆代工企业，聚焦于特色存储、数模混合和三维集成等业务领域，可提供基于多种技术节点、不同工艺平台的各类半导体产品晶圆代工。半导体行业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业。近年来，国家相继出台各类法规政策，大力扶持半导体行业的发展。相关涉及的主要法律、法规和规范性文件如下：

| 序号 | 发布时间 | 发布机关 | 法律法规及政策 | 主要内容 |
|----|-------|------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2024年 | 发改委、工信部、财政 | 《关于做好2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或 | 2024年享受税收优惠政策的集成电路企业是指集成电路线宽 |

| 序号 | 发布时间 | 发布机关 | 法律法规及政策 | 主要内容 |
|----|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 部、海关总署、国家税务总局 | 项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》(发改高技(2024) 351号) | 小于 65nm (含) 的逻辑电路、存储器生产企业, 线宽小于 0.25 微米 (含) 的特色工艺集成电路生产企业, 集成电路线宽小于 0.5 微米 (含) 的化合物集成电路生产企业和先进封装测试企业。 |
| 2 | 2023 年 | 工信部、财政部 | 《电子信息制造业 2023—2024 年稳增长行动方案》(工信部联电子(2023) 132 号) | 提升产业链现代化水平。聚焦集成电路、新型显示、服务器、光伏等领域, 推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链, 促进产业链上中下游融通创新、贯通发展, 全面提升产业链供应链稳定性。 |
| 3 | 2022 年 | 发改委、工信部、财政部、海关总署、国家税务总局 | 《关于做好 2022 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关法律法规及政策要求的通知》(发改高技(2022) 390 号) | 2022 年享受税收优惠政策的集成电路企业是指集成电路线宽小于 65nm (含) 的逻辑电路、存储器生产企业, 线宽小于 0.25 微米 (含) 的特色工艺集成电路生产企业, 集成电路线宽小于 0.5 微米 (含) 的化合物集成电路生产企业和先进封装测试企业。 |
| 4 | 2021 年 | 中央网络安全和信息化委员会 | 《“十四五”国家信息化规划》 | 专栏 7: 加快集成电路关键技术攻关。推动计算芯片、存储芯片等创新, 加快集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发。 |
| 5 | 2021 年 | 国务院 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》 | 在事关国家安全和全局的基础核心领域, 制定实施战略性新兴产业科学计划和科学工程。瞄准集成电路等前沿领域, 实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。 |
| 6 | 2020 年 | 国务院 | 《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发(2020) 8 号) | 产业发展环境, 在财税、投融资、研究开发、人才、知识产权等方面给予集成电路产业和软件产业诸多优惠政策。明确在一定时期内, 集成电路线宽小于 65 nm (含) 的逻辑电路、存储器生产企业, 线宽小于 0.25 微米 (含) 的特色工艺集成电路生产企业 (含掩模版、8 英寸及以上硅片生产企业) 进口自用生产性原材料、消耗品, 净化室专用建筑材料、配套系统和集成电路生 |

| 序号 | 发布时间 | 发布机关 | 法律法规及政策 | 主要内容 |
|----|------|------|---------|----------------|
| | | | | 产设备零配件，免征进口关税。 |

根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），公司所处行业属于战略性新兴产业之“新一代信息技术产业（代码 1）”项下的“电子核心产业（代码 1.2）”中的“新型电子元器件及设备制造”（分类代码：1.2.1）及“集成电路制造”（分类代码：1.2.4），公司主要业务和产品符合国家相关产业政策和国家经济发展战略的要求。

（2）公司拥有关键核心技术等先进技术或产品情况

参见本文件“一、发行人基本情况”之“（三）核心技术与研发水平”。

（3）公司科技创新能力、科技成果转化能力情况

在特色存储领域，公司近十余年来持续深耕 NOR Flash 晶圆代工，是中国大陆目前规模最大的 NOR Flash 制造厂商。截至 2024 年 3 月底，公司 NOR Flash 累计出货量超过 130 万片晶圆，与主要客户保持稳定合作关系。

在数模混合领域，公司与 CIS 行业头部客户保持稳定合作关系，所提供晶圆代工的 CIS 产品已广泛覆盖消费、工业、医疗、汽车等各项应用领域；RF-SOI 晶圆代工方面，已与多家国内头部设计公司客户开展合作。

在三维集成领域，公司双晶圆堆叠、多晶圆堆叠、2.5D 等平台相关技术已实现大规模量产应用，三维异构集成工艺正与产业链上下游企业合作展开相关产品研发生产。

报告期各期，公司营业收入分别为 313,842.37 万元、350,725.34 万元、381,453.85 万元和 91,252.09 万元，整体呈现稳定增长趋势。公司高度重视研发投入与技术创新，自主掌握了一系列关键核心技术。截至 2024 年 3 月 31 日，公司已获授权的发明专利共计 692 项、实用新型专利 237 项。

公司核心技术成功应用于主营业务，实现了与产业的深度融合，产业化水平较高。报告期内，公司主营业务收入均依赖于核心技术实现，核心技术产品收入占营业收入比例分别为 93.36%、95.07%、99.51%及 99.97%。

（4）公司市场地位以及市场认可度情况

报告期内，公司先后承担十余项国家级、省市级重大科研项目，技术研发成果曾荣获“中国专利优秀奖”、“湖北科技进步一等奖”、“湖北专利奖金奖”等奖项及荣誉。公司入选第一批国家鼓励的集成电路企业名单，连续多年位列中国半导体行业协会“中国半导体制造十大企业”。

从具体业务领域来看：在特色存储及数模混合业务方面，公司是中国大陆规模最大的 NOR Flash 制造厂商，CIS 晶圆代工技术平台布局完整、技术实力领先，拥有多年稳定量产的 BSI 工艺和键合工艺，自主开发的 55nm RF-SOI 技术国内领先并已实现产品量产；在三维集成业务方面，公司是国内极少数拥有多晶圆堆叠、异构集成工艺能力的厂商，TSV、混合键合等核心技术处于国际领先水平。

综上，新芯股份在所处行业地位突出、市场认可度高。

2、发行人符合科技创新行业领域的要求

公司所属科技创新行业领域见下表：

| | | |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司所属行业领域 | <input checked="" type="checkbox"/> 新一代信息技术 | 公司主要从事半导体晶圆代工业务，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司所处行业为第五条（一）中所规定的“新一代信息技术领域”之“半导体和集成电路”。 根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），公司所处行业为战略性新兴产业分类中的“新型电子元器件及设备制造”（分类代码：1.2.1）及“集成电路制造”（分类代码：1.2.4）。 |
| | <input type="checkbox"/> 高端装备 | |
| | <input type="checkbox"/> 新材料 | |
| | <input type="checkbox"/> 新能源 | |
| | <input type="checkbox"/> 节能环保 | |
| | <input type="checkbox"/> 生物医药 | |
| | <input type="checkbox"/> 符合科创板定位的其他领域 | |

公司主要从事 12 英寸特色工艺半导体晶圆代工业务，属于新一代信息技术领域的依据充分。

A 股同样从事晶圆代工的其他上市公司中，就所属行业领域披露情况如下表所示：

| 代码 | 名称 | 主营业务 | 行业领域归类 |
|-----------|------|---------------|-----------|
| 688981.SH | 中芯国际 | 集成电路晶圆代工及配套服务 | 新一代信息技术领域 |
| 688347.SH | 华虹公司 | 半导体晶圆代工业务 | 新一代信息技术领域 |

| 代码 | 名称 | 主营业务 | 行业领域归类 |
|-----------|------|---------------------------|-----------|
| 688249.SH | 晶合集成 | 12 英寸晶圆代工业务 | 新一代信息技术领域 |
| 688469.SH | 芯联集成 | MEMS 和功率器件等领域的晶圆代工及封装测试业务 | 新一代信息技术领域 |

3、发行人符合科创属性相关指标的要求

根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》《科创属性评价指引（试行）》，公司符合科创属性相关评价指标的要求，具体如下：

| 科创属性相关指标 | 是否符合 | 指标情况 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 最近三年研发投入占营业收入比例5%以上，或最近三年研发投入金额累计在8,000.00万元以上 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 2021年、2022年及2023年，公司累计研发投入为68,816.78万元，累计在8,000.00万元以上 |
| 研发人员占当年员工总数的比例不低于10% | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 截至2023年末，公司员工总数为1,901人，其中研发人员为313人，研发人员占比为16.47% |
| 应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利7项以上 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 截至2024年3月末，公司已取得应用于公司主营业务的发明专利600余项 |
| 最近三年营业收入复合增长率达到25%，或最近一年营业收入金额达到3亿元 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 2023年，公司营业收入为38.15亿元 |

（二）发行人符合国家产业政策的理由和依据

发行人主要从事半导体特色工艺晶圆代工。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为制造业门类中的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为制造业门类中的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。

根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），公司所处行业战略性新兴产业分类中的“新型电子元器件及设备制造”（分类代码：1.2.1）及“集成电路制造”（分类代码：1.2.4）。

（三）保荐人核查程序及意见

保荐人主要履行了以下程序：

（1）查阅发行人所在领域相关产业政策、行业研究报告、同行业公司公开资料，分析行业竞争格局及发行人行业地位情况；

（2）访谈发行人管理层、技术人员，了解技术水平先进性及客观依据；

- (3) 公开搜集相关竞品关键性能指标，与发行人同级别产品进行分析比较；
- (4) 获取发行人报告期内产品销售明细；
- (5) 走访报告期内主要客户，了解发行人产品先进性情况；
- (6) 查阅发行人核心技术人员简历，了解核心技术人员的科研能力及技术储备情况；
- (7) 查阅发行人报告期内研发费用明细表及主要研发项目研发记录文件，分析发行人研发项目开展及研发投入情况；
- (8) 查阅了发行人取得的专利证书及专利申请文件，取得了国家知识产权局专利登记簿副本；

经核查，保荐人认为，发行人符合科创板定位及国家产业政策。

九、保荐人关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的逐项说明

(一) 发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条之“(一) 符合中国证监会规定的发行条件”规定

1、发行人申请首次公开发行股票符合《注册办法》第十条的规定

(1) 保荐人查验了发行人工商档案，发行人改制设立有关内部决策、审计、评估及验资文件，并核查了发行人现行有效的公司章程及报告期内的财务报表及审计报告。发行人前身新芯有限公司于 2006 年 4 月注册成立，并以股改基准日经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算，发行人持续经营时间在三年以上。

经核查，保荐人认为：发行人是依法设立且持续经营 3 年以上的股份有限公司，符合《注册办法》第十条的规定。

(2) 保荐人查阅了发行人历次股东大会（股东会）、董事会、监事会、董事会专门委员会的会议文件，股东大会、董事会和监事会议事规则以及相关制度文件。

经核查，保荐人认为：发行人依法建立健全了股东大会、董事会、监事会以

及独立董事、董事会秘书制度，已经具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册办法》第十条的规定。

2、发行人申请首次公开发行股票符合《注册办法》第十一条的规定

(1) 保荐人查阅了发行人有关财务基础资料和安永华明会计师出具的标准无保留意见的《审计报告》（安永华明（2024）审字第 70070915_B02 号），核查了发行人的重要会计科目明细账、重大合同、财务制度、经主管税务机关确认的纳税资料等资料。经核查，保荐人认为：发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告，符合《注册办法》第十一条的规定。

(2) 保荐人查阅了发行人各项内部控制制度，核查了发行人报告期内重大违法违规情况，并查阅了安永华明会计师出具的《内部控制审核报告》（安永华明（2024）专字第 70070915_B02 号）。经核查，保荐人认为：发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《注册办法》第十一条的规定。

3、发行人申请首次公开发行股票符合《注册办法》第十二条的规定

(1) 符合《注册办法》第十二条第（一）款的规定

①保荐人查阅了发行人主要财产的权属凭证、相关合同等资料，对发行人运营情况进行尽职调查。经核查，发行人具备与经营有关的业务体系，合法拥有与主营业务相关的设备、商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，发行人资产完整。

②保荐人查阅了发行人股东大会、董事会、监事会会议资料，查看了发行人聘任高级管理人员的相关协议，抽查了签署的《劳动合同》，取得了发行人及其董事、监事、高级管理人员的书面确认，以及对有关人员进行了访谈。经核查，截至本上市保荐书出具日，发行人高级管理人员未在主要股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，未在主要股东及其控制的其他企业领取薪酬；财务人员均系公司专职工作人员，未在主要股东及其控制的其他企业中兼职，

发行人人员独立。

③保荐人查阅了发行人及其子公司的财务管理制度，对发行人财务部门等有关人员进行了访谈和征询，复核了安永华明会计师出具的《内部控制审核报告》（安永华明（2024）专字第 70070915_B02 号）。经核查，发行人具有独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户，发行人财务独立。

④保荐人查阅了发行人的公司章程、三会议事规则等制度文件，了解发行人的公司治理结构、组织机构和职能部门的设置情况，访谈了发行人相关高级管理人员。经核查，发行人的机构设置独立于控股股东及其控制的其他关联企业，未发生与控股股东及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，发行人机构独立。

⑤保荐人取得了发行人控股股东出具的关于避免同业竞争的承诺，查阅了发行人与关联企业签订的相关合同。经核查，发行人业务独立，与控股股东不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

综上，保荐人认为：发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

（2）符合《注册办法》第十二条第（二）款的规定

保荐人核查了发行人重大采购合同及主要供应商等资料，了解发行人主营业务开展情况；查阅了报告期内发行人历次股东大会（股东会）、董事会、监事会及董事会专门委员会会议资料，取得了最近 2 年内发行人核心技术人员名单、简历、劳动合同等资料，对发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况及原因进行了核查。保荐人查阅了发行人工商档案、控股股东出具的说明文件，并复核了发行人律师出具的法律意见书。

经核查，保荐人认为：发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最

近 2 年无实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《注册办法》第十二条第（二）款的规定。

（3）符合《注册办法》第十二条第（三）款的规定

保荐人查阅了发行人的经营资料、重大资产权属文件、财务报告和审计报告、企业信用报告等资料，核查发行人涉及诉讼仲裁等情况，并与发行人律师进行了沟通核实，分析相关行业研究资料、行业分析报告及行业主管部门制定的行业发展规划等，访谈了发行人相关高级管理人员。

经核查，保荐人认为：发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，不存在重大偿债风险，不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册办法》第十二条第（三）款的规定。

4、发行人申请首次公开发行股票符合《注册办法》第十三条的规定

（1）保荐人核查了发行人营业执照、公司章程、主营业务实际经营情况及开展相关业务所涉及的准入许可及相关资质情况，查阅了与发行人所从事行业相关的国家产业政策。

经核查，保荐人认为：发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《注册办法》第十三条的规定。

（2）保荐人核查了报告期内发行人及其控股股东的涉诉情况，通过网络检索查询上述主体涉及诉讼、仲裁、贿赂、行政处罚等相关情形，查阅了相关主管部门出具的合规证明，并与发行人律师进行了沟通核实。

经核查，保荐人认为，最近 3 年内，发行人及其控股股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《注册办法》第十三条的规定。

（3）保荐人取得并查阅了董事、监事和高级管理人员提供的无犯罪证明、调查表及中国证监会等网站检索等资料，核对发行人律师出具的法律意见。

经核查，保荐人认为，发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近 3 年内

受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《注册办法》第十三条的规定。

(二)发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条之“(二)发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元”规定

经核查，发行人本次发行前股本总额为8,479,006,412元，公司本次拟公开发行股票不超过2,826,335,470股，发行人本次发行后总股本不超过11,305,341,882股，发行后发行人股本总额不低于人民币3,000万元。

(三)发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条之“(三)公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上”规定

经核查，本次发行后，公司股本总额超过人民币 4 亿元，本次拟发行股份占发行后总股本的比例达到 10% 以上。

(四)发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条之“(四)市值及财务指标符合本规则规定的标准”规定

根据安永华明会计师出具的《审计报告》（安永华明（2024）审字第 70070915_B02 号），发行人最近一年营业收入为 381,453.85 万元。结合最近一次外部股权融资情况，以及可比公司在境内外市场的估值情况，预计发行人发行后总市值不低于人民币 30 亿元。

综上所述，发行人本次发行上市申请适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条中规定的第（四）项标准，即“预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元。”

(五)发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条之“(五)上海证券交易所规定的其他上市条件”规定

经核查，发行人符合上海证券交易所规定的其他上市条件。

十、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排

| 主要事项 | 具体计划 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一) 持续督导事项 | 证券上市当年剩余时间及其后 3 个完整会计年度 |
| 1、督导发行人有效执行并完善防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度 | (1) 督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度； (2) 与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况 |
| 2、督导发行人有效执行并完善防止其高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度 | (1) 督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度； (2) 与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况 |
| 3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见 | (1) 督导发行人有效执行《公司章程》《关联交易管理制度》等保障关联交易公允性和合规性的制度，履行有关关联交易的信息披露制度； (2) 督导发行人及时向保荐人通报将进行的重大关联交易情况，并对关联交易发表意见 |
| 4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件 | (1) 督导发行人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务； (2) 在发行人发生须进行信息披露的事件后，审阅信息披露文件及向中国证监会、上交所提交的其他文件 |
| 5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项 | (1) 督导发行人执行已制定的《募集资金管理制度》等制度，保证募集资金的安全性和专用性； (2) 持续关注发行人募集资金的专户储存、投资项目的实施等承诺事项； (3) 如发行人拟变更募集资金及投资项目等承诺事项，保荐人要求发行人通知或咨询保荐人，并督导其履行相关信息披露义务 |
| (二) 保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定 | (1) 定期或者不定期对发行人进行回访、查阅保荐工作需要的发行人材料； (2) 列席发行人的股东大会、董事会和监事会； (3) 对有关部门关注的发行人相关事项进行核查，必要时可聘请相关证券服务机构配合 |
| (三) 发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定 | (1) 发行人已在保荐协议中承诺配合保荐人履行保荐职责，及时向保荐人提供与本次保荐事项有关的真实、准确、完整的文件； (2) 接受保荐人尽职调查和持续督导的义务，并提供有关资料或进行配合 |
| (四) 其他安排 | 无 |

(以下无正文)

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于武汉新芯集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖章页）

项目协办人：

林 轲

保荐代表人：

李 冬


寻国良

内核负责人：

杨晓涛

保荐业务负责人：

郁伟君

法定代表人/董事长：

朱 健



华源证券股份有限公司

关于

武汉新芯集成电路股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）



華源證券股份有限公司

HUAYUAN SECURITIES CO., LTD

（西宁市南川工业园区创业路 108 号）

目 录

| | |
|----------------------------------------------------|----|
| 目 录..... | 1 |
| 一、发行人基本情况 | 3 |
| 二、 发行人本次发行情况 | 15 |
| 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员 | 16 |
| 四、保荐人与发行人之间的关联关系 | 17 |
| 五、保荐人承诺事项 | 17 |
| 六、保荐人对本次发行上市的推荐结论 | 18 |
| 七、本次证券发行履行的决策程序 | 19 |
| 八、保荐人关于发行人符合科创板定位及国家产业政策的说明 | 19 |
| 九、保荐人关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的逐项说明 | 24 |
| 十、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 | 28 |

华源证券股份有限公司

关于武汉新芯集成电路股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书

上海证券交易所：

华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”）接受武汉新芯集成电路股份有限公司（以下简称“发行人”、“新芯股份”、“公司”）的委托，担任新芯股份首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第2号——上市保荐书内容与格式》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的本上市保荐书真实、准确和完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《武汉新芯集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。

一、发行人基本情况

（一）基本信息

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| 中文名称 | 武汉新芯集成电路股份有限公司 |
| 英文名称 | Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. |
| 注册资本 | 847,900.6412 万元人民币 |
| 法定代表人 | 孙鹏 |
| 有限公司成立日期 | 2006 年 4 月 21 日 |
| 股份公司成立日期 | 2024 年 3 月 29 日 |
| 住所 | 武汉市东湖新技术开发区高新四路 18 号 |
| 邮政编码 | 430205 |
| 联系电话 | 027-87708900 |
| 传真 | 027-81738000 |
| 互联网网址 | www.xmcwh.com |
| 电子信箱 | ir@xmcwh.com |
| 信息披露和投资者关系负责部门 | 董事会办公室 |
| 信息披露和投资者关系负责人及联系方式 | 汤海燕，027-87708900 |

（二）主营业务

公司是国内领先的半导体特色工艺晶圆代工企业，聚焦于特色存储、数模混合和三维集成等业务领域，可提供基于多种技术节点、不同工艺平台的各类半导体产品晶圆代工。

在特色存储领域，公司是中国大陆规模最大的 NOR Flash 制造厂商，拥有业界领先的代码型闪存技术，制造工艺涵盖浮栅（Floating Gate，又称 ETOX）型与电荷俘获（Charge Trap，又称 SONOS）型两种主流结构。公司在浮栅工艺上制程节点涵盖 65nm 到 50nm，其中 50nm 技术平台具有业内领先的存储密度。

在数模混合领域，公司具备 CMOS 图像传感器制造全流程工艺，拥有多年稳定量产的 BSI 工艺和堆栈式工艺，技术平台布局完整、技术实力领先；公司 12 英寸 RF-SOI 工艺平台已经实现 55nm 产品量产，射频器件性能国内领先，广

泛应用于智能手机等无线通讯领域。

在三维集成领域，公司拥有国际领先的硅通孔、混合键合等核心技术，公司双晶圆堆叠、多晶圆堆叠、芯片-晶圆异构集成以及硅转接板技术应用不断拓展。

截至 2024 年 3 月末，公司共拥有两座 12 英寸晶圆厂。报告期内，公司先后承担十余项国家级、省市级重大科研项目，技术研发成果曾荣获“中国专利优秀奖”、“湖北科技进步一等奖”、“湖北专利奖金奖”等奖项及荣誉。公司入选第一批国家鼓励的集成电路企业名单，连续多年位列中国半导体行业协会“中国半导体制造十大企业”。

报告期内，公司以特色存储业务为支撑、以三维集成技术为牵引，各项业务平台深化协同，持续进行技术迭代。目前，公司多项技术及产品已广泛应用于汽车电子、工业控制、消费电子、计算机等下游领域，与各细分行业头部厂商形成了稳定、良好的合作关系。未来，公司致力于成为三维时代半导体先进制造引领者，助力客户提升核心竞争力，繁荣中国半导体高端应用。

（三）核心技术与研发水平

1、公司主要核心技术概况

截至本上市保荐书签署日，公司的主要核心技术平台情况如下：

| 序号 | 类别 | 核心技术平台 | 技术工艺特征及先进性表征 | 技术来源 | 先进性 |
|----|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1 | 特色存储 | 独立式非易失性代码型闪存（NOR Flash） | <p>①拥有业内领先的代码型闪存技术，支持 1.8~3.3V 工作电压，自主研发的 50nm 技术平台具有业界领先的存储密度。公司“代码型闪存芯片成套核心技术研发及其产业化”曾获 2020 湖北科技进步一等奖。</p> <p>②公司全平台 12 英寸 NOR Flash 晶圆累计出货超百万片。公司自有品牌 NOR Flash 产品涵盖 1.2V 到 3.3V 输入电压，其擦写速度与耐受性、数据保持等可靠性与特性指标业内领先。</p> <p>③所提供晶圆代工及自有品牌的 NOR Flash 产品广泛应用于计算机、消费电子、汽车电子、工业控制、物联网设备等各项领域。</p> | 自主研发 | 国际领先 |
| 2 | 数模混合 | 射频绝缘体上硅（RF-SOI） | <p>①自主开发的 55nm RF-SOI 技术，可提供射频开关、低噪声放大器、天线调谐器、功率放大器等多样化的器件集成，具有性能优值好、谐波低、截止频率高、噪声系数低、功率高等性能优势。</p> <p>②射频器件关键性能如低噪声放大器截止频率、射频开关性能优值(FoM, Figure of Merit)、天线调谐器</p> | 自主研发 | 国内领先 |

| 序号 | 类别 | 核心技术平台 | 技术工艺特征及先进性表征 | 技术来源 | 先进性 |
|----|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | | | 工作电压等达到国内领先水平。 ③已实现 55nm RF-SOI 产品量产。 | | |
| | | CMOS 图像传感器 (CIS) | ①具备 55nmCIS 全流程制造工艺, 像素尺寸覆盖 0.7um 及以上, 拥有成熟量产的 BSI、堆栈式后道工艺, 信噪比、动态范围、暗电流等工艺相关的关键性能指标达到国际先进水平。 ②CIS 平台技术品类丰富, 覆盖消费、车载、医疗等不同应用领域。 ③拥有成熟的 CIS 技术配套设备及产线管理能力, 稳定量产超过 10 年。 ④中国大陆首家量产 BSI 技术的晶圆代工厂, 工艺能力及可靠性与全球领先水平相当。 | 自主研发 | 国际先进 |
| 3 | 三维集成 | 双晶圆堆叠 | ①基于大规模生产验证的熔融键合工艺堆叠晶圆, 通过铜或钨金属填充硅通孔实现垂直互联, 提供多种连接密度以支持多样化应用需求。自主知识产权的工艺方案, 关键技术荣获中国专利优秀奖。 ②提供业界领先的混合键合密度、精度、强度和可靠性, 有效增加传输带宽, 减少延时及功耗, 提高芯片性能。 ③支持不同技术节点、不同制程种类及来源的晶圆预处理, 及成熟的背面减薄和背面引线工艺方案, 支持多样化晶圆减薄厚度需求。 ④该技术相较业界同行具有混合键合密度高的显著优点。 | 自主研发 | 国际领先 |
| | | 多晶圆堆叠 | ①拥有国际领先的多片晶圆堆叠技术, 基于硅通孔、混合键合、晶圆减薄、重布线层等工艺组合, 支持多片晶圆垂直互联, 可显著提高单位面积内的存储或功能密度。 ②拥有自主知识产权的多片堆叠应力管理、晶边处理等成套工艺及模块化工艺流程, 提供行业领先的良率及生产周期。 ③该技术相较业界微凸块封装形式具有功耗更低、散热性能更好的特点。 | 自主研发 | 国际领先 |
| | | 芯片-晶圆异构集成 | ①拥有自主知识产权的芯片对晶圆垂直互联工艺, 可实现不同尺寸、不同材料、不同功能的芯片-晶圆间无凸点直接键合异构集成。 ②拥有中国大陆首条自主可控的三维异构集成工艺产线, 支持需求灵活、创新架构设计的高集成度复杂芯片的生产制造。 | 自主研发 | 国际领先 |
| | | 2.5D (硅转接板 Interposer) | 拥有国际先进的 2.5D (硅转接板) 技术, 包含多光罩超大尺寸拼接、超高密度深沟槽电容及深硅穿孔技术, 为集成系统提供具有亚微米级精度铜互连线的封装基板, 显著减小系统延迟、插损及功耗等。 | 自主研发 | 国际先进 |

2、核心技术在主营业务及产品或服务中的应用和贡献情况

报告期内, 发行人核心技术广泛应用于发行人各类技术平台中。发行人应用核心技术产生的收入及其占营业收入比重情况如下:

单位：万元

| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 核心技术产生的收入 | 91,226.43 | 379,579.62 | 333,431.66 | 292,991.61 |
| 营业收入 | 91,252.09 | 381,453.85 | 350,725.34 | 313,842.37 |
| 占营业收入的比重 | 99.97% | 99.51% | 95.07% | 93.36% |

3、核心技术的保护措施

(1) 知识产权保护

公司为保护无形资产完整，明确科研成果归属，制定了知识产权管理的相关制度，建立了涵盖专利申请、商标注册、商业秘密保护等多层次的知识产权管理体系。例如，针对职务发明创造，公司明确规定其专利申请权和专利权归属于公司，同时应就获得授权的专利对职务发明创造的发明人给予奖金；此外，对于不适宜进行公开披露的重要技术发明作为商业秘密进行保护。

(2) 保密与竞业禁止制度

为确保职务作品归属，避免员工流动导致的技术秘密外泄，防范与员工之间的知识产权争议，公司整体制订了关于员工竞业禁止限制方面的规范制度，同时与主要技术人员在劳动合同及相关附件中就保密义务及竞业禁止义务进行了详细约定。例如，要求相关人员在任职期间及离职后对公司机密信息应严格保密，以及明确其竞业限制/禁止的范围、期限以及违约责任等。

(3) 员工跟投计划

为打造稳定、高效、专业的研发团队，促进研发人员的科研创新热情，锁定高级管理人员及核心员工，发行人亦于报告期内制定了员工跟投计划，通过员工持股的方式实现对主要技术人员的有效激励，从而进一步稳固公司研发团队、保护公司核心技术。

（四）科研实力和成果情况

1、公司参与的重大科研项目情况

公司作为国内领先的半导体特色工艺晶圆代工企业，在相关业务领域具有强大科研实力和工艺创新能力，长期承担及参与各类重大科研项目。报告期内，公司承担、参与了十余项国家级和省市级重大科研项目。

2、专利情况

截至 2024 年 3 月 31 日，发行人及其子公司已获授权的发明专利共计 692 项（其中包含 71 项境外专利、10 项共有专利）、实用新型专利 237 项。

3、公司及其产品获得重要奖项的情况

报告期内，公司获得的主要荣誉奖项如下：

| 序号 | 荣誉名称 | 颁发单位 | 获得时间 |
|----|-------------------------|-----------------|--------|
| 1 | 2022 年度湖北省高新技术企业百强 | 湖北省科技厅 | 2023 年 |
| 2 | 武汉市科技领军企业 | 武汉市科学技术局 | 2023 年 |
| 3 | 第二十三届中国专利优秀奖 | 国家知识产权局 | 2022 年 |
| 4 | 2022 年度湖北省知识产权优势企业（专利类） | 湖北省知识产权局 | 2022 年 |
| 5 | 2021 年度湖北省高新技术企业百强 | 湖北省科技厅 | 2022 年 |
| 6 | 2020 年中国半导体制造十大企业 | 中国半导体行业协会 | 2021 年 |
| 7 | 湖北省专利奖金奖 | 湖北省人民政府 | 2021 年 |
| 8 | 2021 年中国 IC 设计成就奖 | AspenCore | 2021 年 |
| 9 | 第六届全国专业技术人才先进集体 | 中组部、中宣部、人社部、科技部 | 2021 年 |
| 10 | 湖北省科技进步一等奖 | 湖北省人民政府 | 2021 年 |

（五）主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

| 项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 流动资产合计 | 8,012,179,812.59 | 4,509,826,947.32 | 5,137,881,477.50 | 3,869,274,464.15 |
| 非流动资产合计 | 10,776,186,462.55 | 10,523,694,846.39 | 6,386,510,495.94 | 4,948,121,379.46 |

| | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 资产总计 | 18,788,366,275.14 | 15,033,521,793.71 | 11,524,391,973.44 | 8,817,395,843.61 |
| 流动负债合计 | 2,633,342,157.04 | 5,364,507,370.53 | 2,832,587,602.84 | 1,781,080,327.11 |
| 非流动负债合计 | 3,792,012,186.18 | 2,476,362,586.24 | 1,513,508,654.01 | 1,379,244,683.79 |
| 负债合计 | 6,425,354,343.22 | 7,840,869,956.77 | 4,346,096,256.85 | 3,160,325,010.90 |
| 归属于母公司股东/所有者权益合计 | 12,363,011,931.92 | 7,192,651,836.94 | 7,178,295,716.59 | 5,657,070,832.71 |
| 股东/所有者权益合计 | 12,363,011,931.92 | 7,192,651,836.94 | 7,178,295,716.59 | 5,657,070,832.71 |

2、合并利润表主要数据

单位：元

| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 912,520,938.29 | 3,814,538,543.11 | 3,507,253,369.18 | 3,138,423,731.70 |
| 营业利润 | 5,077,465.18 | 427,433,228.23 | 780,122,034.46 | 673,738,189.59 |
| 净利润 | 14,866,383.55 | 393,755,969.26 | 716,602,607.25 | 638,730,833.73 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,866,383.55 | 393,755,969.26 | 716,602,607.25 | 638,756,851.63 |

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 276,093,126.38 | 1,709,894,135.31 | 2,275,120,647.49 | 1,356,127,632.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,442,496,981.24 | -3,353,877,477.76 | -1,504,124,225.04 | -1,394,588,659.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,835,134,203.08 | 1,139,725,287.19 | 58,504,477.01 | 654,688,582.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,319,643,763.74 | 2,647,710,736.37 | 3,118,645,456.99 | 2,131,285,783.06 |

4、主要财务指标

| 财务指标 | 2024年1-3月/2024年3月31日 | 2023年度/2023年12月31日 | 2022年度/2022年12月31日 | 2021年度/2021年12月31日 |
|------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 流动比率（倍） | 3.04 | 0.84 | 1.81 | 2.17 |
| 速动比率（倍） | 2.56 | 0.61 | 1.34 | 1.76 |
| 资产负债率（母公司） | 34.18% | 52.13% | 37.66% | 35.78% |
| 资产负债率（合并） | 34.20% | 52.16% | 37.71% | 35.84% |

| 财务指标 | 2024 年 1-3 月 /2024 年 3 月 31 日 | 2023 年度/2023 年 12 月 31 日 | 2022 年度/2022 年 12 月 31 日 | 2021 年度/2021 年 12 月 31 日 |
|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 应收账款周转率 (次/年) | 9.32 | 7.73 | 6.03 | 5.49 |
| 存货周转率(次/ 年) | 2.42 | 2.26 | 2.13 | 3.37 |
| 息税折旧摊销前 利润(万元) | 31,815.96 | 139,954.92 | 152,265.58 | 135,465.52 |
| 利息保障倍数 (倍) | 10.18 | 32.00 | 71.28 | 68.06 |
| 归属于母公司所 有者的净利润(万 元) | 1,486.64 | 39,375.60 | 71,660.26 | 63,875.69 |
| 扣除非经常性损 益后归属于母公 司所有者的净利 润(万元) | 1,381.49 | 37,259.71 | 66,873.33 | 54,014.16 |
| 研发投入占营业 收入的比例 | 7.52% | 6.86% | 6.65% | 6.16% |
| 每股经营活动产 生的现金流量(元 /股) | 0.03 | 0.30 | 0.39 | 0.24 |
| 每股净现金流量 (元/股) | 0.32 | -0.08 | 0.17 | 0.11 |
| 归属于母公司所 有者的每股净资 产(元/股) | 1.46 | 1.24 | 1.24 | 1.02 |

注：上述部分主要财务指标的计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 3、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值，2024 年 1-3 月数据已折算全年，下同
- 4、存货周转率=营业成本/存货平均账面价值，2024 年 1-3 月数据已折算全年，下同
- 5、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出(财务费用项下)+折旧与摊销
- 6、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出(财务费用项下)
- 7、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入
- 8、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- 9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
- 10、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末股本总额

(六) 主要风险

1、与行业相关的风险

(1) 宏观经济波动和行业周期性的风险

半导体行业发展受宏观经济影响显著，全球经济走势、行业景气度以及产能周期等因素都对半导体行业产生重要影响，导致行业存在一定周期特征。报告期内，半导体行业出现了整体波动的情况。2020年以来，随着全球信息化和数字化

的加速发展、下游消费类需求的快速增长，半导体产业呈现出明显的高投资趋势，全球制造产能快速扩张，致使市场在2022年出现供过于求的情况，消费电子市场总体需求走低，半导体行业景气度下行。2023年全球半导体市场规模缩水至5591.36亿美元，较2022年下降8.92%。截至目前，全球半导体行业处于从低位逐步回升的时期。

在晶圆代工制造环节，下游市场需求的波动和低迷会导致晶圆代工的需求下降，从而影响行业整体价格和利润率水平。因此，如若发行人未能及时应对上述宏观经济环境变化及行业周期性的整体波动，可能会对公司经营业绩产生潜在不利影响。

（2）国际贸易摩擦的风险

目前，半导体晶圆代工行业制造与供应体系整体仍有赖于全球化分工合作。报告期内，公司生产运营所需的主要机器设备及原材料部分采购自境外供应商；此外，公司销售区域覆盖中国大陆及中国香港、亚洲其他地区及欧美等境内外区域。如未来国际间贸易摩擦加剧，相关国家可能调整出口管制政策，导致公司面临设备、原材料供应受到一定限制或进口成本增加，境外采购及销售可能因此受到影响，对公司业务及经营造成不利影响。

（3）工艺平台技术迭代无法满足市场需求的风险

半导体晶圆代工行业具有工艺技术迭代快、资金投入大、研发周期长等特点，伴随相关工艺技术的革新及竞争水平的提高，预计未来市场对公司工艺技术迭代更新的速度和成效将提出更高的要求，如若公司在相关领域的进展未能取得良好效果、未能适配市场需求，则可能导致公司难以保持市场竞争地位，进而对经营及财务状况产生不利影响。

（4）产业政策变化的风险

半导体产业作为我国战略支柱产业，得益于国家政策支持，近年来实现了快速有力发展。相关产业政策覆盖税收、人才培养和技术创新等各方面，有效提升了行业内企业市场竞争力和可持续发展潜力。然而，产业政策面临变化的不确定性，如未来国家相关产业政策出现不利变化，将可能一定程度上对公司业务发展、人才引进和生产经营等造成不利影响。

2、与发行人相关的风险

（1）固定资产投资风险

晶圆代工行业属于典型的资本密集型行业，固定资产投资的需求较高。截至2024年3月31日，公司固定资产的账面价值为816,571.45万元，占公司总资产的比例为43.46%；公司在建工程的账面价值为211,447.96万元，占公司总资产的比例为11.25%。公司持续的产能扩充对后续资金投入提出了较高要求，公司的资金筹措能力面临较大的考验。

同时，半导体行业晶圆制造环节产能扩充呈现周期性变化特征，下游需求变化速度较快而上游产能增减通常需要更长时间。因此，固定资产投资建设周期内可能面临下游市场需求的快速变化，供应端产能增长与市场需求存在错配风险。若公司新增固定资产投资无法适应市场需求或在相关技术领域的收入规模增长有限，则可能无法消化大额固定资产投资带来的新增折旧，导致公司面临盈利能力下降的风险。

（2）经营业绩及毛利率波动风险

报告期各期，公司营业收入分别为313,842.37万元、350,725.34万元、381,453.85万元和91,252.09万元，归属于母公司股东的净利润分别为63,875.69万元、71,660.26万元、39,375.60万元和1,486.64万元，公司综合毛利率分别为32.11%、36.51%、22.69%和16.64%，报告期内，公司营业收入呈现增长趋势，受市场需求、产品结构调整等因素影响，公司毛利率水平存在一定波动。

如未来受到行业周期、市场波动、下游市场需求变化、原材料成本上升、固定资产折旧增加，或者公司技术平台推广不及预期、产能利用率下降等影响，且公司未能采取有效措施及时应对上述市场变化，将面临经营业绩及毛利率波动的风险，极端情况下有可能导致公司出现发行上市当年营业利润同比下滑50%以上甚至亏损的风险。

（3）无实际控制人的风险

截至本上市保荐书签署日，长控集团直接持有发行人68.19%的股份，系发行人的控股股东。长控集团的股权结构较为分散，结合长控集团的历史沿革、公司章程、董事高管提名及任命情况、股东会和董事会对重大事项的表决结果、内部

治理结构及日常经营管理决策，长控集团不存在实际控制人，因此发行人不存在实际控制人。

公司控股股东较为分散的股权结构可能影响其对于下属子公司的决策效率，使得发行人存在错失发展机遇的风险。此外，公司未来若控股股东发生股权变动可能间接导致发行人控制权发生变动，进而给公司经营和业务稳定带来潜在的风险。

（4）存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为73,253.49万元、135,597.33万元、124,796.54万元及126,577.50万元，占资产总额的比例分别为8.31%、11.77%、8.30%及6.74%。公司通常根据客户订单和销售预测进行生产备货，但如果下游客户因其生产销售计划原因调整采购需求，暂缓或取消订单，或者受行业市场竞争加剧的影响，公司的产品市场价格下降，公司存货将面临减值的风险，从而对公司经营业绩造成一定的不利影响。

（5）供应商集中度较高的风险

报告期内，公司向前五大原材料供应商合计采购额分别为32,348.03万元、49,477.58万元、29,364.57万元和9,599.93万元，占当期采购总额的比例分别为41.46%、42.62%、34.46%和35.51%，供应商集中度相对较高。尽管目前发行人所需采购的原材料供应相对充足，但若未来由于贸易摩擦或其他不可抗力因素导致原材料供应商延迟交货、限制供应或提高价格，可能对发行人持续生产经营能力造成不利影响。

（6）知识产权的风险

发行人所处的晶圆代工行业属于典型的技术密集型行业，包括生产工艺、专利、集成电路布图设计、商业秘密等在内的知识产权是公司在行业内保持自身竞争力的关键。随着公司业务发展和市场开拓，公司的知识产权在未来可能遭受不同形式的侵犯，中国以及其他国家或地区的知识产权法律提供的保护或这些法律的执行未必有效，公司实施或保护知识产权的能力可能受到限制，且成本可能较高。因此，如果公司的知识产权不能得到充分保护，公司未来业务发展和经营业绩可能会受到不利影响。同时，其他竞争者可能指控公司侵犯其知识产权，从而

对公司业务发展和经营业绩产生不利影响。

（7）研发人员不足或流失的风险

半导体行业属于技术密集型、人才密集型产业，特别是公司所处的晶圆代工领域，生产工艺流程复杂，技术研发涉及多学科交叉，对研发人员的专业程度、经验水平、综合素质要求较高，对高水平研发人员的培养周期长、难度大。因此公司存在研发人员不足或流失的风险，如未能保持研发团队的稳定性并持续扩充、吸引人才，则可能影响技术更新迭代进程，使公司在行业竞争格局中处于不利境地，对生产经营造成不利影响。

（8）内部控制风险

公司结合自身经营管理特点建立了较为完善的法人治理结构和风险控制体系。但报告期内，公司生产经营规模不断扩大，资产规模、员工人数持续增长，随着募集资金投资项目的实施，公司资产规模和人员规模也将进一步扩大，对公司组织管理制度、经营管理能力、法人治理水平和风险控制体系均提出了更高的要求。若公司内部管理制度不能有效贯彻落实并持续完善，将面临较大的管理失效风险。

（9）安全生产的风险

公司生产涉及部分机械设备操作且所需的部分原材料存在一定危险性，对于操作人员的技术及操作工艺流程要求较高。若公司在安全生产管理制度上出现漏洞、管理不规范或生产人员在生产过程中未严格按照安全生产制度进行生产作业等，则公司存在发生安全生产事故，导致员工伤亡、财产损失、产线停工及受到相关部门行政处罚的风险，将对公司的生产经营产生不利影响。

（10）汇率波动风险

公司交易存在人民币、美元、日元等多种币种结算。报告期内，公司汇兑损益分别为-1,372.82万元、2,612.86万元、-3,208.60万元和-1,011.38万元。公司在经营过程中重视外币资产和外币负债在规模上的匹配，合理控制外汇风险敞口。但未来如果境内外经济环境、政治形势、货币政策、融资环境等因素发生变化，使得本外币汇率大幅波动，公司仍将面临汇兑损失的风险。

公司记账本位币为美元，因公司披露的财务数据以人民币列报，需对相关报表进行汇率折算。如果未来人民币兑美元汇率发生重大变化，将可能对折算后的人民币财务数据带来一定偏差，一定程度上放大比较期间财务数据的变化幅度，并影响投资者对财务报表的使用。

（11）环境保护的风险

发行人在生产经营中会产生废水、废气和固体废物，需遵守环境保护方面的相关法律法规。发行人在日常生产经营过程中制定并执行了严格的环保制度，但未来如果公司由于环保设施运行故障等原因发生环境污染事件，可能将受到相关部门的行政处罚，并对公司的生产经营产生不利影响。同时，如果国家或地方出台更为严格的环保要求，公司需投入相应资金对现有环保设施进行升级改造。

（12）募投项目短期影响经营业绩或未来无法达到预期收益的风险

公司本次募集资金投资项目实施后，公司固定资产规模预计将大幅增加。一方面，由于募投项目的投资回收期较长，在短期内其新增折旧和摊销或将对公司经营业绩产生一定不利影响；另一方面，如果市场环境发生重大不利变化，公司募集资金投资项目产生的收入及利润未能达到预计水平，公司亦将面临无法达到预期收益的风险。

3、其他风险

（1）发行失败的风险

本次发行的结果将受到证券市场整体情况、公司经营业绩、投资者对公司价值的判断等多种因素的影响。公司股票发行价格确定后，若发行人网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，应当根据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的相关规定中止发行。中止发行后，在中国证监会予以注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，公司需向上交所备案，方可重新启动发行。若公司未在中国证监会予以注册决定的有效期内完成发行，公司将面临发行失败的风险。

二、发行人本次发行情况

| (一) 本次发行的基本情况 | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 股票种类 | 人民币普通股 (A 股) | | |
| 每股面值 | 1.00 元 | | |
| 发行股数 | 不超过 2,826,335,470 股 | 占发行后总股本比例 | 不超过 25% |
| 其中: 发行新股数量 | 不超过 2,826,335,470 股 | 占发行后总股本比例 | 不超过 25% |
| 股东公开发售股份数量 | - | 占发行后总股本比例 | - |
| 发行后总股本 | 不超过 11,305,341,882 股 (不考虑超额配售选择权) | | |
| 每股发行价格 | 【】元 | | |
| 发行市盈率 | 【】倍 (发行价格除以每股收益, 每股收益按发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算) | | |
| 发行前每股净资产 | 【】元 | 发行前每股收益 | 【】元 |
| 发行后每股净资产 | 【】元 | 发行后每股收益 | 【】元 |
| 发行市净率 | 【】 (按每股发行价格除以发行后每股净资产计算) | | |
| 发行方式 | 采用网下向配售对象询价发行和网上资金申购定价发行相结合的方式或采用证券监管部门认可的其他发行方式 | | |
| 发行对象 | 符合规定资格的询价对象和在上交所开立账户并已开通科创板市场交易账户的合格投资者或证券监管部门认可的其他发行对象 | | |
| 承销方式 | 余额包销 | | |
| 募集资金总额 | 【】万元 | | |
| 募集资金净额 | 【】万元 | | |
| 募集资金投资项目 | 12 英寸集成电路制造生产线三期项目 | | |
| | 特色技术迭代及研发配套项目 | | |
| 发行费用概算 | 本次发行费用总额为【】万元, 包括: 承销及保荐费【】万元、律师费用【】万元、审计及验资费用【】万元、信息披露费用【】万元、发行手续费用【】万元 | | |
| 高级管理人员、员工拟参与战略配售情况 | 若公司决定实施高管及员工战略配售, 则在本次公开发行股票注册后、发行前, 履行内部程序审议该事项的具体方案, 并依法进行披露 | | |
| 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 | 保荐人将安排相关子公司参与本次发行战略配售, 具体按照上交所相关规定执行。保荐人及相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案, 并按规定向上交所提交相关文件 | | |
| 拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则 | 无 | | |

| (二) 本次发行上市的重要日期 | |
|------------------------|-----------|
| 刊登发行公告日期 | 【】年【】月【】日 |
| 开始询价推介日期 | 【】年【】月【】日 |
| 刊登定价公告日期 | 【】年【】月【】日 |
| 申购日期和缴款日期 | 【】年【】月【】日 |
| 股票上市日期 | 【】年【】月【】日 |

三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员

(一) 保荐人和保荐代表人、项目协办人的联系方式

保荐人（主承销商）：华源证券股份有限公司

保荐代表人：吕谦、胡春梅

联系地址：武汉市江汉区青年路 278 号中海中心 32F-34F

电 话：027-51663000

传 真：027-51663067

(二) 具体负责本次推荐的保荐代表人

本保荐人指定吕谦、胡春梅作为新芯股份首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人。

吕谦先生：保荐代表人，法学硕士，具有律师从业资格。华源证券投行业务三部负责人。参与和主持的项目包括：华康医疗辅导上市项目、吉和昌与奥克股份资产重组项目。在上述项目执业过程中，吕谦先生严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

胡春梅女士：保荐代表人，民商法学硕士，具有律师从业资格。作为签字保荐代表人和项目负责人主持了远翔新材（301300）的创业板上市项目；参与过新宁物流（300013）IPO、江南嘉捷（601313）IPO、东山精密（002384）IPO、胜利精密（002426）IPO、狼和医疗 IPO 项目，参与过亿晶光电（600537）非公开发行等项目。

（三）项目协办人及其他项目组成员

本保荐人未指定项目协办人。

其他项目组成员包括：李洪敏、李娟、胡理想、董佳勋、李冠宇、任东升、谢宏、魏然。

四、保荐人与发行人之间的关联关系

1、截至本上市保荐书出具日，本次发行的保荐人（主承销商）国泰君安全资子公司国泰君安证裕投资有限公司、华源证券全资子公司华证资本投资（北京）有限公司拟参与本次发行战略配售。

截至本上市保荐书出具日，发行人持股 0.37% 的股东国鑫创投与本次发行的保荐机构国泰君安同受上海国际集团有限公司控制。武汉金控为华源证券间接持股 50% 的控股股东，通过国芯基金持有发行人控股股东长控集团 5.98% 的股权，通过武汉芯盛持有发行人 3.52% 的股份；湖北科投为华源证券间接持股 16.31% 的股东，间接持有发行人 5% 以上股份；发行人董事程驰光为华源证券董事。

除上述情况外，不存在保荐人或其控股股东、重要关联方持有或者通过参与本次战略配售持有发行人或其控股股东、重要关联方股份的情况；

2、截至本上市保荐书出具日，不存在发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐人或其控股股东、重要关联方股份的情况；

3、截至本上市保荐书出具日，不存在保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员持有发行人或其控股股东及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东及重要关联方任职的情况；

4、截至本上市保荐书出具日，不存在保荐人的控股股东、重要关联方与发行人控股股东、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

5、截至本上市保荐书出具日，不存在保荐人与发行人之间的其他关联关系。

五、保荐人承诺事项

（一）保荐人对本次上市保荐的一般承诺

保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所的相关规定，对发行人及其控

股股东进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。根据发行人的委托，保荐人组织编制了本次公开发行股票并上市申请文件，同意推荐发行人本次证券发行上市，并据此出具本上市保荐书。

（二）保荐人对本次上市保荐的逐项承诺

保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会、上交所等有关规定对发行人进行了充分的尽职调查和辅导，保荐人有充分理由确信发行人至少符合下列要求：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证本上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9、中国证监会规定的其他事项。

六、保荐人对本次发行上市的推荐结论

在充分尽职调查、审慎核查的基础上，本保荐人认为，新芯股份首次公开发行股票并在科创板上市符合《公司法》《证券法》《注册办法》《保荐业务管理办

法》等法律、法规和规范性文件中有关首次公开发行股票并在科创板上市的条件。同意推荐新芯股份本次证券发行上市。

七、本次证券发行履行的决策程序

经核查，发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上交所有关规定的决策程序，具体如下：

2024年8月25日，发行人召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。

2024年9月20日，发行人召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了上述与本次发行上市相关的议案。

2024年9月23日，发行人召开第一届董事会第八次会议，审议通过了有关募投项目金额调整的议案。

八、保荐人关于发行人符合科创板定位及国家产业政策的说明

（一）发行人符合科创板定位的理由和依据

1、发行人符合科创板支持方向

（1）公司符合国家科技创新战略情况

公司是国内领先的半导体特色工艺晶圆代工企业，聚焦于特色存储、数模混合和三维集成等业务领域，可提供基于多种技术节点、不同工艺平台的各类半导体产品晶圆代工。半导体行业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业。近年来，国家相继出台各类法规政策，大力扶持半导体行业的发展。相关涉及的主要法律、法规和规范性文件如下：

| 序号 | 发布时间 | 发布机关 | 法律法规及政策 | 主要内容 |
|----|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2024年 | 发改委、工信部、财政部、海关总署、国家税务总局 | 《关于做好2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2024〕351号） | 2024年享受税收优惠政策的集成电路企业是指集成电路线宽小于65nm（含）的逻辑电路、存储器生产企业，线宽小于0.25微米（含）的特色工艺集成电路生产企业，集成电路线宽小于0.5微米（含）的化合物集成电路生产企业和先进封 |

| 序号 | 发布时间 | 发布机关 | 法律法规及政策 | 主要内容 |
|----|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 装测试企业。 |
| 2 | 2023 年 | 工信部、财政部 | 《电子信息制造业 2023—2024 年稳增长行动方案》（工信部联电子〔2023〕132 号） | 提升产业链现代化水平。聚焦集成电路、新型显示、服务器、光伏等领域，推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链，促进产业链上中下游融通创新、贯通发展，全面提升产业链供应链稳定性。 |
| 3 | 2022 年 | 发改委、工信部、财政部、海关总署、国家税务总局 | 《关于做好 2022 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关法律法规及政策要求的通知》（发改高技〔2022〕390 号） | 2022 年享受税收优惠政策的集成电路企业是指集成电路线宽小于 65nm（含）的逻辑电路、存储器生产企业，线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电路生产企业，集成电路线宽小于 0.5 微米（含）的化合物集成电路生产企业和先进封装测试企业。 |
| 4 | 2021 年 | 中央网络安全和信息化委员会 | 《“十四五”国家信息化规划》 | 专栏 7：加快集成电路关键技术攻关。推动计算芯片、存储芯片等创新，加快集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发。 |
| 5 | 2021 年 | 国务院 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》 | 在事关国家安全和全局的基础核心领域，制定实施战略性科学计划和科学工程。瞄准集成电路等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。 |
| 6 | 2020 年 | 国务院 | 《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8 号） | 产业发展环境，在财税、投融资、研究开发、人才、知识产权等方面给予集成电路产业和软件产业诸多优惠政策。明确在一定时期内，集成电路线宽小于 65 nm（含）的逻辑电路、存储器生产企业，线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电路生产企业（含掩模版、8 英寸及以上硅片生产企业）进口自用生产性原材料、消耗品，净化室专用建筑材料、配套系统和集成电路生产设备零配件，免征进口关税。 |

根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），公司所处行业属于战略性新兴产业之“新一代信息技术产业（代码 1）”项下的“电子核心产业（代码 1.2）”中的“新型电子元器件及设备制造”（分类代码：

1.2.1) 及“集成电路制造”（分类代码：1.2.4），公司主要业务和产品符合国家相关产业政策和国家经济发展战略的要求。

(2) 公司拥有关键核心技术等先进技术或产品情况

参见本文件“一、发行人基本情况”之“（三）核心技术与研发水平”。

(3) 公司科技创新能力、科技成果转化能力情况

在特色存储领域，公司近十余年来持续深耕 NOR Flash 晶圆代工，是中国大陆目前规模最大的 NOR Flash 制造厂商。截至 2024 年 3 月底，公司 NOR Flash 累计出货量超过 130 万片晶圆，与主要客户保持稳定合作关系。

在数模混合领域，公司与 CIS 行业头部客户保持稳定合作关系，所提供晶圆代工的 CIS 产品已广泛覆盖消费、工业、医疗、汽车等各项应用领域；RF-SOI 晶圆代工方面，已与多家国内头部设计公司客户开展合作。

在三维集成领域，公司双晶圆堆叠、多晶圆堆叠、2.5D 等平台相关技术已实现大规模量产应用，三维异构集成工艺正与产业链上下游企业合作展开相关产品研发生产。

报告期各期，公司营业收入分别为 313,842.37 万元、350,725.34 万元、381,453.85 万元和 91,252.09 万元，整体呈现稳定增长趋势。公司高度重视研发投入与技术创新，自主掌握了一系列关键核心技术。截至 2024 年 3 月 31 日，公司已获授权的发明专利共计 692 项、实用新型专利 237 项。

公司核心技术成功应用于主营业务，实现了与产业的深度融合，产业化水平较高。报告期内，公司主营业务收入均依赖于核心技术实现，核心技术产品收入占营业收入比例分别为 93.36%、95.07%、99.51% 及 99.97%。

(4) 公司市场地位以及市场认可度情况

报告期内，公司先后承担十余项国家级、省市级重大科研项目，技术研发成果曾荣获“中国专利优秀奖”、“湖北科技进步一等奖”、“湖北专利奖金奖”等奖项及荣誉。公司入选第一批国家鼓励的集成电路企业名单，连续多年位列中国半导体行业协会“中国半导体制造十大企业”。

从具体业务领域来看：在特色存储及数模混合业务方面，公司是中国大陆规模最大的 NOR Flash 制造厂商，CIS 晶圆代工技术平台布局完整、技术实力领先，拥有多年稳定量产的 BSI 工艺和键合工艺，自主开发的 55nm RF-SOI 技术国内领先并已实现产品量产；在三维集成业务方面，公司是国内极少数拥有多晶圆堆叠、异构集成工艺能力的厂商，TSV、混合键合等核心技术处于国际领先水平。

综上，新芯股份在所处行业地位突出、市场认可度高。

2、发行人符合科技创新行业领域的要求

公司所属科技创新行业领域见下表：

| | | |
|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司所属行业领域 | <input checked="" type="checkbox"/> 新一代信息技术 | 公司主要从事半导体晶圆代工业务，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司所处行业为第五条（一）中所规定的“新一代信息技术领域”之“半导体和集成电路”。 根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），公司所处行业为战略性新兴产业分类中的“新型电子元器件及设备制造”（分类代码：1.2.1）及“集成电路制造”（分类代码：1.2.4）。 |
| | <input type="checkbox"/> 高端装备 | |
| | <input type="checkbox"/> 新材料 | |
| | <input type="checkbox"/> 新能源 | |
| | <input type="checkbox"/> 节能环保 | |
| | <input type="checkbox"/> 生物医药 | |
| | <input type="checkbox"/> 符合科创板定位的其他领域 | |

公司主要从事 12 英寸特色工艺半导体晶圆代工业务，属于新一代信息技术领域的依据充分。

A 股同样从事晶圆代工的其他上市公司中，就所属行业领域披露情况如下表所示：

| 代码 | 名称 | 主营业务 | 行业领域归类 |
|-----------|------|---------------------------|-----------|
| 688981.SH | 中芯国际 | 集成电路晶圆代工及配套服务 | 新一代信息技术领域 |
| 688347.SH | 华虹公司 | 半导体晶圆代工业务 | 新一代信息技术领域 |
| 688249.SH | 晶合集成 | 12 英寸晶圆代工业务 | 新一代信息技术领域 |
| 688469.SH | 芯联集成 | MEMS 和功率器件等领域的晶圆代工及封装测试业务 | 新一代信息技术领域 |

3、发行人符合科创属性相关指标的要求

根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》《科创属

性评价指引（试行）》，公司符合科创属性相关评价指标的要求，具体如下：

| 科创属性相关指标 | 是否符合 | 指标情况 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 最近三年研发投入占营业收入比例5%以上，或最近三年研发投入金额累计在8,000.00万元以上 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 2021年、2022年及2023年，公司累计研发投入为68,816.78万元，累计在8,000.00万元以上 |
| 研发人员占当年员工总数的比例不低于10% | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 截至2023年末，公司员工总数为1,901人，其中研发人员为313人，研发人员占比为16.47% |
| 应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利7项以上 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 截至2024年3月末，公司已取得应用于公司主营业务的发明专利600余项 |
| 最近三年营业收入复合增长率达到25%，或最近一年营业收入金额达到3亿元 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 2023年，公司营业收入为38.15亿元 |

（二）发行人符合国家产业政策的理由和依据

发行人主要从事半导体特色工艺晶圆代工。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为制造业门类中的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为制造业门类中的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。

根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），公司所处行业战略性新兴产业分类中的“新型电子元器件及设备制造”（分类代码：1.2.1）及“集成电路制造”（分类代码：1.2.4）。

（三）保荐人核查程序及意见

保荐人主要履行了以下程序：

- （1）查阅发行人所在领域相关产业政策、行业研究报告、同行业公司公开资料，分析行业竞争格局及发行人行业地位情况；
- （2）访谈发行人管理层、技术人员，了解技术水平先进性及客观依据；
- （3）公开搜集相关竞品关键性能指标，与发行人同级别产品进行分析比较；
- （4）获取发行人报告期内产品销售明细；
- （5）走访报告期内主要客户，了解发行人产品先进性情况；
- （6）查阅发行人核心技术人员简历，了解核心技术人员的科研能力及技术储备情况；

(7) 查阅发行人报告期内研发费用明细表及主要研发项目研发记录文件，分析发行人研发项目开展及研发投入情况；

(8) 查阅了发行人取得的专利证书及专利申请文件，取得了国家知识产权局专利登记簿副本；

经核查，保荐人认为，发行人符合科创板定位及国家产业政策。

九、保荐人关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的逐项说明

(一) 发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条之“(一) 符合中国证监会规定的发行条件”规定

1、发行人申请首次公开发行股票符合《注册办法》第十条的规定

(1) 保荐人查验了发行人工商档案，发行人改制设立有关内部决策、审计、评估及验资文件，并核查了发行人现行有效的公司章程及报告期内的财务报表及审计报告。发行人前身新芯有限公司于 2006 年 4 月注册成立，并以股改基准日经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算，发行人持续经营时间在三年以上。

经核查，保荐人认为：发行人是依法设立且持续经营 3 年以上的股份有限公司，符合《注册办法》第十条的规定。

(2) 保荐人查阅了发行人历次股东大会（股东会）、董事会、监事会、董事会专门委员会的会议文件，股东大会、董事会和监事会议事规则以及相关制度文件。

经核查，保荐人认为：发行人依法建立健全了股东大会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书制度，已经具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册办法》第十条的规定。

2、发行人申请首次公开发行股票符合《注册办法》第十一条的规定

(1) 保荐人查阅了发行人有关财务基础资料和安永华明会计师出具的标准无保留意见的《审计报告》（安永华明（2024）审字第 70070915_B02 号），核查了发行人的重要会计科目明细账、重大合同、财务制度、经主管税务机关确认的

纳税资料等资料。经核查，保荐人认为：发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告，符合《注册办法》第十一条的规定。

(2) 保荐人查阅了发行人各项内部控制制度，核查了发行人报告期内重大违法违规情况，并查阅了安永华明会计师出具的《内部控制审核报告》（安永华明（2024）专字第 70070915_B02 号）。经核查，保荐人认为：发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《注册办法》第十一条的规定。

3、发行人申请首次公开发行股票符合《注册办法》第十二条的规定

(1) 符合《注册办法》第十二条第（一）款的规定

①保荐人查阅了发行人主要财产的权属凭证、相关合同等资料，对发行人运营情况进行尽职调查。经核查，发行人具备与经营有关的业务体系，合法拥有与主营业务相关的设备、商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，发行人资产完整。

②保荐人查阅了发行人股东大会、董事会、监事会会议资料，查看了发行人聘任高级管理人员的相关协议，抽查了签署的《劳动合同》，取得了发行人及其董事、监事、高级管理人员的书面确认，以及对有关人员进行了访谈。经核查，截至本上市保荐书出具日，发行人高级管理人员未在主要股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，未在主要股东及其控制的其他企业领取薪酬；财务人员均系公司专职工作人员，未在主要股东及其控制的其他企业中兼职，发行人人员独立。

③保荐人查阅了发行人及其子公司的财务管理制度，对发行人财务部门等有关人员进行了访谈和征询，复核了安永华明会计师出具的《内部控制审核报告》（安永华明（2024）专字第 70070915_B02 号）。经核查，发行人具有独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户，发行人财务独立。

④保荐人查阅了发行人的公司章程、三会议事规则等制度文件，了解发行人的公司治理结构、组织机构和职能部门的设置情况，访谈了发行人相关高级管理人员。经核查，发行人的机构设置独立于控股股东及其控制的其他关联企业，未发生与控股股东及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，发行人机构独立。

⑤保荐人取得了发行人控股股东出具的关于避免同业竞争的承诺，查阅了发行人与关联企业签订的相关合同。经核查，发行人业务独立，与控股股东不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

综上，保荐人认为：发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

（2）符合《注册办法》第十二条第（二）款的规定

保荐人核查了发行人重大采购合同及主要供应商等资料，了解发行人主营业务开展情况；查阅了报告期内发行人历次股东大会（股东会）、董事会、监事会及董事会专门委员会会议资料，取得了最近2年内发行人核心技术人员名单、简历、劳动合同等资料，对发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况及原因进行了核查。保荐人查阅了发行人工商档案、控股股东出具的说明文件，并复核了发行人律师出具的法律意见书。

经核查，保荐人认为：发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近2年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近2年无实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《注册办法》第十二条第（二）款的规定。

（3）符合《注册办法》第十二条第（三）款的规定

保荐人查阅了发行人的经营资料、重大资产权属文件、财务报告和审计报告、企业信用报告等资料，核查发行人涉及诉讼仲裁等情况，并与发行人律师进行了沟通核实，分析相关行业研究资料、行业分析报告及行业主管部门制定的行业发

展规划等，访谈了发行人相关高级管理人员。

经核查，保荐人认为：发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，不存在重大偿债风险，不存在重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册办法》第十二条第（三）款的规定。

4、发行人申请首次公开发行股票符合《注册办法》第十三条的规定

（1）保荐人核查了发行人营业执照、公司章程、主营业务实际经营情况及开展相关业务所涉及的准入许可及相关资质情况，查阅了与发行人所从事行业相关的国家产业政策。

经核查，保荐人认为：发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《注册办法》第十三条的规定。

（2）保荐人核查了报告期内发行人及其控股股东的涉诉情况，通过网络检索查询上述主体涉及诉讼、仲裁、贿赂、行政处罚等相关情形，查阅了相关主管部门出具的合规证明，并与发行人律师进行了沟通核实。

经核查，保荐人认为，最近3年内，发行人及其控股股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《注册办法》第十三条的规定。

（3）保荐人取得并查阅了董事、监事和高级管理人员提供的无犯罪证明、调查表及中国证监会等网站检索等资料，核对发行人律师出具的法律意见。

经核查，保荐人认为，发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《注册办法》第十三条的规定。

（二）发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.1条之“（二）发行后股本总额不低于人民币3,000万元”规定

经核查，发行人本次发行前股本总额为8,479,006,412元，公司本次拟公开发行股

票不超过 2,826,335,470 股，发行人本次发行后总股本不超过 11,305,341,882 股，发行后发行人股本总额不低于人民币 3,000 万元。

(三)发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条之“(三)公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上”规定

经核查，本次发行后，公司股本总额超过人民币 4 亿元，本次拟发行股份占发行后总股本的比例达到 10% 以上。

(四)发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条之“(四)市值及财务指标符合本规则规定的标准”规定

根据安永华明会计师出具的《审计报告》（安永华明（2024）审字第 70070915_B02 号），发行人最近一年营业收入为 381,453.85 万元。结合最近一次外部股权融资情况，以及可比公司在境内外市场的估值情况，预计发行人发行后总市值不低于人民币 30 亿元。

综上所述，发行人本次发行上市申请适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条中规定的第（四）项标准，即“预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元。”

(五)发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条之“(五)上海证券交易所规定的其他上市条件”规定

经核查，发行人符合上海证券交易所规定的其他上市条件。

十、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排

| 主要事项 | 具体计划 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一) 持续督导事项 | 证券上市当年剩余时间及其后 3 个完整会计年度 |
| 1、督导发行人有效执行并完善防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度 | (1) 督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度； (2) 与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况 |
| 2、督导发行人有效执行并完善防止其高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度 | (1) 督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度； (2) 与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况 |

| 主要事项 | 具体计划 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见 | <p>(1) 督导发行人有效执行《公司章程》《关联交易管理制度》等保障关联交易公允性和合规性的制度，履行有关关联交易的信息披露制度；</p> <p>(2) 督导发行人及时向保荐人通报将进行的重大关联交易情况，并对关联交易发表意见</p> |
| 4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件 | <p>(1) 督导发行人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务；</p> <p>(2) 在发行人发生须进行信息披露的事件后，审阅信息披露文件及向中国证监会、上交所提交的其他文件</p> |
| 5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项 | <p>(1) 督导发行人执行已制定的《募集资金管理制度》等制度，保证募集资金的安全性和专用性；</p> <p>(2) 持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；</p> <p>(3) 如发行人拟变更募集资金及投资项目等承诺事项，保荐人要求发行人通知或咨询保荐人，并督导其履行相关信息披露义务</p> |
| (二 保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定 | <p>(1) 定期或者不定期对发行人进行回访、查阅保荐工作需要的发行人材料；</p> <p>(2) 列席发行人的股东大会、董事会和监事会；</p> <p>(3) 对有关部门关注的发行人相关事项进行核查，必要时可聘请相关证券服务机构配合</p> |
| (三 发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定 | <p>(1) 发行人已在保荐协议中承诺配合保荐人履行保荐职责，及时向保荐人提供与本次保荐事项有关的真实、准确、完整的文件；</p> <p>(2) 接受保荐人尽职调查和持续督导的义务，并提供有关资料或进行配合</p> |
| (四) 其他安排 | 无 |

(以下无正文)

(本页无正文,为《华源证券股份有限公司关于武汉新芯集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖章页)

保荐代表人:



吕 谦



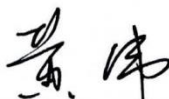
胡春梅

内核负责人:



晏珍珍

保荐业务负责人:



黄 伟

法定代表人、总经理:



邓 晖

